

業 務

概覽

本集團產銷離散式功率半導體，以旗下「PFC」品牌進軍中國、台灣及其他亞洲地區市場。往績記錄期間，本集團的離散式功率半導體主要包括可按多種封裝類封裝的一種整流器蕭基二極管。2015年，本集團完成開發其首個MOSFET(一種晶體管)產品型號。本集團的MOSFET現正處於建立產品組合階段，而本集團將繼續其研發工作，(其中包括)以開發更多不同規格的MOSFET產品型號，藉此擴大MOSFET的產品組合。本集團的離散式功率半導體用作電源供應器的整流器，應用範圍遍及多種電子器材，計有流動電話、筆記簿型電腦及LED電視等電子消費品，以至汽車及太陽能電池等。本集團的離散式功率半導體應用於電源供應器，應用範圍遍及多種電子器材，達至供電節能效果，從而提高電子器材的能源效益。

本集團亦從事原材料(即EPI)貿易業務。本集團採購EPI作為其主要原材料，該半導體材料為生產加工晶圓的核心原材料。本集團出售其部分EPI予中國晶圓代工廠公司，該公司是位於中國深圳的晶圓代工廠，於往績記錄期間內為本集團五大供應商之一，本集團再向其採購可以本集團所售同類EPI生產的加工晶圓，其於截至2016年3月31日止三個月亦為本集團五大客戶之一。有關往績記錄期間內中國晶圓代工廠公司以及本集團與中國晶圓代工廠公司的交易的進一步詳情，請參閱本文件「業務一客戶一原材料貿易」一節。

本集團旗下研發團隊設於台灣，並主要以改善產品性能、開發新產品及技術為重心。本集團的離散式功率半導體使用由本集團內部研發團隊開發的自有專利元件結構及製造方法。於最後實際可行日期，本集團持有在美國、台灣及中國就其離散式功率半導體的元件結構及／或製造方法註冊的46項專利。另一方面，於最後實際可行日期，本集團(i)已在美國、台灣及中國為其SLVF及HPTR系列金氧半蕭基整流器註冊「SLVF」及「HPTR」商標；及(ii)在香港註冊☑商標。

本集團在位於中國廣東順德的順德生產廠房製造其大部分產品。於離散式功率半導體製造流程中，本集團於順德生產廠房進行製造流程中的封裝及測試流程，並向外聘晶圓加工廠外判晶圓加工流程。本集團亦向外聘封裝公司外判若干封裝類型的離散式功率半導體的封裝流程。於最後實際可行日期，本集團在順德生產廠房有合共94名僱員。本集團在台灣及香港經營業務辦事處，銷售後勤辦事處則位於中國深圳。台灣銷售辦事處監督本集團的銷售及營銷業務。本集團離散式功率半導體大多售予分銷商，彼等則轉售予本集團產品的直接用家，即主要為電源供應器製造商，電源供應器將於其後用於多種電子器材。

業 務

本集團的營業額自截至2014年12月31日止年度約16.2百萬美元增至截至2015年12月31日止年度約18.1百萬美元，增幅相當於約11.6%或1.9百萬美元。截至2016年3月31日止三個月，本集團錄得收入約5.6百萬美元，較去年同期增加約52.0%或1.9百萬美元。本集團的毛利率維持穩定，截至2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月分別約為28.4%、28.5%及30.0%。

下表所載為往績記錄期間按業務分部劃分的本集團收入詳情：

	截至2014年 12月31日止 年度		截至2015年 12月31日止 年度		截至2015年 3月31日止 三個月		截至2016年 3月31日止 三個月	
	千美元	%	千美元	%	千美元	%	千美元	%
	(未經審核)							
離散式功率								
半導體銷售	15,112	93.2	16,694	92.3	3,164	85.7	5,113	91.1
原材料貿易	1,109	6.8	1,401	7.7	528	14.3	498	8.9
總計	16,221	100.0	18,095	100.0	3,692	100.0	5,611	100.0

下表所載為往績記錄期間按分銷地區劃分的本集團收入地域詳情：

	截至2014年 12月31日止 年度		截至2015年 12月31日止 年度		截至2015年 3月31日止 三個月		截至2016年 3月31日止 三個月	
	千美元	%	千美元	%	千美元	%	千美元	%
	(未經審核)							
台灣	6,744	41.6	7,649	42.3	1,740	47.1	2,616	46.6
中國(附註1)	8,267	51.0	9,662	53.4	1,835	49.7	2,764	49.3
亞洲，中國及台灣 除外(附註2)	1,210	7.4	784	4.3	117	3.2	231	4.1
總計	16,221	100.0	18,095	100.0	3,692	100.0	5,611	100.0

附註：

1. 包括(i)向中國晶圓代工廠公司銷售EPI；及(ii)向蜆壳多媒體集團銷售離散式功率半導體。
2. 亞洲區(中國及台灣除外)所得收入主要來自向韓國分銷商的銷售。

業 務

下表所載為本集團於往績記錄期間的分部毛利及毛利率詳情：

	離散式功率半導體銷售				原材料貿易			
	截至12月31日止年度		截至3月31日止三個月		截至12月31日止年度		截至3月31日止三個月	
	2014年	2015年	2015年	2016年	2014年	2015年	2015年	2016年
	千美元	千美元	千美元 (未經審核)	千美元	千美元	千美元	千美元 (未經審核)	千美元
分部收入	15,112	16,694	3,164	5,113	1,109	1,401	528	498
分部毛利	4,237	4,606	940	1,488	373	558	211	198
分部毛利率	28.0%	27.6%	29.7%	29.1%	33.6%	39.8%	40.0%	39.8%

往績記錄期間後及直至最後實際可行日期所簽訂的離散式功率半導體銷售合同值約達10.0百萬美元。

市場及競爭

全球離散式半導體市場主要由數十年來主導市場的跨國公司控制，市場份額集中度高，中國(包括香港)離散式半導體市場亦是如此。2015年，全球半導體市場收入約達335.5十億美元，當中，中國半導體市場收入約達95.2十億美元，按收入計，相當於全球半導體市場28.4%。本集團收入約為18.1百萬美元，相當於全球半導體市場收入約0.005%(以及中國半導體市場約0.02%)。

半導體市場整體趨升，2008年至2015年全球半導體市場及中國半導體市場錄得複合年增長率分別約4.4%及11.3%。根據Prismark，蕭基整流器(即本集團的主要離散式功率半導體產品)在2015年全球售出的63十億件整流器中分佔約40%或25.2十億件。蕭基整流器自2011年的21十億件增至2015年的25.2十億件，相當於2011年至2015年間複合年增長率4.7%。MOSFET在2015年售出的4.8十億件功率晶體管中分佔約75%或36十億件，並於2011年至2015年間按複合年增長率約2%增長。

儘管全球市場及中國市場的十大市場參與者一直持續分佔總產量逾半，以致所售產品選擇有限的較小型參與者難以開拓市場，但由於市場上的最終用家的數目眾多，因此仍然存在商機。有關離散式半導體市場競爭態勢的進一步詳情，請參閱本文件「行業概覽—市場參與者及競爭態勢」一節。

本公司主要與發售類似產品的離散式半導體製造商競爭。董事認為，本公司的競爭優勢包括但不限於(i)作為離散式功率半導體製造商質量卓越美譽度高；(ii)研發實力專注精誠助力產品開發改善；(iii)先進生產線與深厚技術專長相輔相承；及(iv)管理團隊實

業 務

力雄厚表現穩定業內經驗廣泛豐富。與此同時，本集團可能存在弱點，例如所售產品數目有限，不及離散式半導體製造商的市場翹楚，本集團目前僅可以其有售產品競爭，而本集團與最終用家的往績不長。

競爭優勢

董事相信以下競爭優勢有助本集團持續成功及提高增長潛力：

作為離散式功率半導體製造商質量卓越美譽度高

董事相信，本集團已在本集團客戶及產品用家間建立產品優質可靠美譽。本集團離散式功率半導體所用而在晶圓上加工的元件結構建基於本集團本身專利設計。本集團的離散式功率半導體應用於電源供應器，應用範圍遍及多種電子器材，達至供電節能效果，從而提高電子器材的能源效益。本集團開發的設計允許更密集封裝（即更高效利用半導體材料），從而在採用某一特定封裝術下，其離散式半導體相對其他離散式半導體性能較佳。

另一方面，本集團設有質控團隊，在生產流程中執行質控制度，保障本集團所用或所製原材料、半成品及成品的質量上乘。本集團存置認可供應商及分包商名單，以供本集團選用作其生產用途採購。該等供應商及分包商基於（其中包括）產品／服務質量往績、交貨準時性及可靠度等因素入選該認可名單。本集團要求其供應商／分包商於交付原／加工材料前提供質量核查報告。本集團就質量及是否符合規格要求取樣檢驗原／加工材料。

本集團就半成品及成品的質控指定專責質控人員，彼等在工人協助下監察各生產工序，確保符合相關質控要求。進行包括但不限於晶粒切割、固晶、線焊及封膠等各階段主要封裝工序後，半成品進行外觀檢查及／或以測試機測試性能，確保符合本集團質量標準。本集團亦不時與客戶溝通，以取得有關產品質量標準方面的回饋。

於最後實際可行日期，本集團質控部由3名高級質控人員組成，負責監督本集團的質控制度，當中2名為TS 16949系列的認可內部審查員。本集團的質控人員平均行業經驗約達20年。

業 務

研發實力專注精誠助力產品開發改善

本集團設有專責研發團隊進行產品性能及新產品開發。於最後實際可行日期，本集團的研發團隊由合共10名成員組成，全體成員均達大專學歷或以上。有關本集團研發實力的進一步詳情，請參閱本文件「業務—研發」一節。

截至2015年12月31日止兩個年度以及2016年（直至最後實際可行日期），本集團在三個司法管轄區（即台灣、美國及中國）分別提交10、8及5項離散式半導體／製造方法專利註冊申請。本集團於2015年完成開發其首個MOSFET（一種晶體管）產品型號。本集團的MOSFET現正處於建立產品組合階段，而本集團將繼續其研發工作，以（其中包括）開發更多不同規格的MOSFET產品型號，藉此擴大MOSFET的產品組合。於最後實際可行日期，本集團為13項台灣專利、25項美國專利以及8項中國專利的註冊擁有人。有關本集團專利的進一步詳情，請參閱本文件下文附錄四「B.有關本集團業務的進一步資料—2.知識產權」一段。

先進生產線與深厚技術專長相輔相承

本集團在順德生產廠房自置一系列生產設備製造不同封裝的電源供應器用離散式功率半導體，應用範圍遍及多種電子器材，計有流動電話、筆記簿型電腦及LED電視等電子消費品，以至汽車及太陽能板等。本集團設有內部工程團隊，負責管理及維護本集團設備，主管設備安裝並進行質量檢測，以及監察設備，確保生產線配合生產流程優化。本集團內部工程團隊在必要時可制訂生產線所需適應調整，安排於短時間內生產不同封裝的離散式功率半導體。本集團認為，由內部工程團隊管理的先進生產線有助提高產品質量及可靠度。

管理團隊實力雄厚表現穩定，業內經驗廣泛豐富

本集團高級管理層團隊擁電子業內深厚技術訣竅，經營管理經驗豐富。本集團執行董事兼行政總裁洪先生主要負責本集團整體管理及經營，並執行本集團的策略規劃，彼自美國加州大學柏克萊分校取得電力工程及電腦科學學士學位，並自美國南加州大學取得工商管理碩士學位，半導體製造及零售的經驗逾18年，過往曾於多家跨國半導體製造商歷任要職。本集團高級管理層團隊成員郭鴻鑫先生、曾昭禮先生及陳美玲女士於半導體業內經驗分別逾31年、26年及16年。憑藉彼等的知識及經

業 務

驗，董事認為彼等亦對半導體業別具遠見，並掌握最新市場趨勢。董事相信，本集團管理層團隊的經驗及專長對日後落實本集團業務策略以作持續發展實屬關鍵。此外，執行董事周先生、非執行董事兼董事長翁先生以及非執行董事鄧先生分別於其各自的專擅領域具有逾15年經驗。有關董事及高級管理層的進一步資料，請參閱本文件「董事及高級管理層」一節。

業務策略

推動本集團離散式功率半導體產能攀升

本集團的離散式功率半導體（以蕭基二極管為主）銷售自截至2014年12月31日止年度約15.1百萬美元增至截至2015年12月31日止年度約16.7百萬美元，並自截至2015年3月31日止三個月約3.2百萬美元增至截至2016年3月31日止三個月約5.1百萬美元，而按「業務—生產設施及產能—生產設備」一節所披露者，截至2015年12月31日止年度，本集團生產流程的設備使用率已約達80%。

本集團將繼續投資於整體產能擴展，以順應其離散式功率半導體日益殷切的需求，並就不同封裝類型的離散式功率半導體擴充產能。將就有關擴產添置的設備包括晶圓測試及分類、晶粒切割、固晶及線焊機器。

本集團有意於截至2016年12月31日止年度動用[編纂]所得款項中約[編纂]萬港元，於截至2017年12月31日止年度約[編纂]港元，以及於截至2018年12月31日止年度約[編纂]港元，以擴充本集團功率半導體的產能，包括添置第四代封裝的DFN封裝類型（QFN類封裝類型）離散式功率半導體的全新封裝生產線，有關進一步詳情，請參閱本文件「行業概覽—半導體市場需求及增長前景—離散式半導體封裝」一節。

於最後實際可行日期，本集團並無計劃通過收購擴張，且尚未物色任何收購目標。

持之以恆致力研發

董事認為其研發實力是本集團業務增長的關鍵，得以改善現有產品表現以及新產品及技術開發。本集團的離散式功率半導體使用由內部研發團隊開發的自有元件專利結構及製造方法，有助本集團產品從競爭對手的產品之中脫穎而出。截至2015年12月31日止

業 務

兩個年度各年以及2016年(直至最後實際可行日期)，本集團在三個司法管轄區(即台灣、美國及中國)分別提交10、8及5項有關元件結構／製造方法的專利註冊申請。

本集團將通過其於台灣的現有研發團隊持續其研發工作。有關本集團研發實力的進一步詳情，請參閱下文「業務—研發」一節。

擴展分銷網絡

本集團的離散式功率半導體客戶主要為分銷商，彼等繼而轉售本集團的半導體產品予本集團產品的直接用戶，即主要為電源供應器製造商，電源供應器將於其後用於多項電子器材。本集團存置一份分銷商名單，於最後實際可行日期有合共16名分銷商，以在中國、台灣及其他亞洲地區市場分銷其產品。

本集團現有銷售團隊將通過物色新分銷商而繼續擴展其分銷網絡，同時與彼等合作，發展與本集團產品用戶的業務關係，從而提高旗下產品對活躍市場中本集團產品直接用戶的滲透率。

另一方面，本集團的離散式功率半導體目前供電源供應器使用，應用範圍遍及多種電子器材，計有流動電話、筆記簿型電腦及LED電視等電子消費品，以至汽車及太陽能板等。董事相信，本集團分銷網絡的擴展亦讓本集團在用途方面擴大產品用戶範圍，藉此提高其產品的收入來源。

業務模式

離散式功率半導體銷售

概覽

本集團產銷離散式功率半導體，以旗下「PFC」品牌進軍中國、台灣及其他亞洲地區市場。往績記錄期間，本集團的離散式功率半導體主要包括可按多種封裝類型封裝的一種整流器蕭基二極管。截至2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月，蕭基二極管的銷售分別約達15.1百萬美元、16.7百萬美元及5.1百萬美元。2016年1月1日至最後實際可行日期期間，蕭基二極管的銷售約達13.6百萬美元，於最後實際可行日期，未交付的蕭基二極管銷售合同價值約達2.9百萬美元。

2015年，本集團完成開發其首個MOSFET(一種晶體管)產品型號。本集團的MOSFET現正處於建立產品組合階段，而本集團將繼續其研發工作，以(其中包括)開發更多不同規格的MOSFET產品型號，藉此擴大MOSFET的產品組合。本集團計劃於2016

業 務

年底前把MOSFET現有產品組合自69個型號增至90個型號，並於2017年另增100個型號。董事認為，建立產品組合可帶動其MOSFET產品需求攀升。2016年1月1日至最後實際可行日期期間的MOSFET銷售約達263,000美元，最後實際可行日期的尚未交付MOSFET銷售合同價值約為200,000美元。

產品開發

本集團旗下研發團隊設於台灣，並主要以改善產品性能、開發新產品及技術為重心。本集團的離散式功率半導體使用由內部研發團隊開發的自有元件結構及製造方法專利。於最後實際可行日期，本集團持有在美國、台灣及中國就其離散式功率半導體的元件結構及／或製造方法註冊的46項專利。另一方面，於最後實際可行日期，本集團(i)已在美國、台灣及中國為其SLVF及HPTR系列金氧半肅基整流器註冊「SLVF」及「HPTR」商標；及(ii)在香港註冊☑商標。有關本集團專利及商標的詳情，請參閱本文件下文附錄四「B.有關本集團業務的進一步資料—2.知識產權」一段。

生產

截至2015年12月31日止兩個年度，本集團產品製造大部分於順德生產廠房由SDMM節能元件分部進行。所進行的製造流程包括封裝及測試流程，晶圓加工流程外判予外聘晶圓加工廠。

順德多媒體與節能元件(廣東)於2015年9月8日及2015年12月31日就資產重組訂立兩份協議，據此，順德多媒體已於2015年12月31日完成向節能元件(廣東)轉讓有關生產離散式功率半導體的全部SDMM節能元件分部生產資產(包括機器、設備、存貨及人員)。本集團亦租用順德生產廠房作為其生產設施，該生產設施佔地總建築面積約5,160平方米，租期自2015年10月1日起至2017年9月30日止。有關本集團與蜆壳多媒體集團的公司架構以及資產重組的進一步詳情，請參閱「歷史、重組及公司架構—業務發展」一節，而有關租賃順德生產廠房的進一步詳情，請參閱本文件「獲豁免持續關連交易—獲豁免持續關連交易—1.節能元件(廣東)與順德多媒體的租賃協議」一節。

資產重組完成後，離散式功率半導體製造由節能元件(廣東)承接，而本集團於順德生產廠房製造旗下產品，其中所有生產資產由本集團擁有，而其工程師及工人則由本集團僱用。於最後實際可行日期，本集團於順德生產廠房的僱員合共94名。有關本集團生產設施及產能的進一步資料，請參閱本文件「業務—生產設施及產能」一節。

業 務

產品銷售

本集團在台灣及香港經營銷售辦事處，銷售後勤辦事處則位於中國深圳。本集團離散式功率半導體大多售予分銷商，彼等則轉售予本集團產品直接用家，即主要為電源供應器製造商，電源供應器將於其後用於多種電子器材。就董事所深知，電子元件製造商（包括電源供應器製造商）聘用分銷商進行採購程序屬市場慣例。本集團客戶（即分銷商）集中採購電源供應器生產所用原材料及元件，以促進及時及高效採購。有關本集團與其分銷商之間安排的進一步詳情，請參閱本文件「業務—銷售及營銷—銷售及分銷渠道」一節。

原材料貿易

本集團亦從事原材料銷售業務（即EPI）。本集團採購EPI作為其主要原材料，該半導體材料為生產加工晶圓的核心原材料。本集團出售其部分EPI予中國晶圓代工廠公司（位於中國深圳的晶圓代工廠），本集團再向其採購可以本集團所售同類EPI生產的加工晶圓。有關往績記錄期間中國晶圓代工廠公司以及內本集團與中國晶圓代工廠公司的交易的進一步詳情，請參閱「業務—客戶—最大客戶」一節。

下表所載為本集團往績記錄期間按業務分部劃分的收入的詳情：

	截至2014年 12月31日止 年度		截至2015年 12月31日止 年度		截至2015年 3月31日止 三個月		截至2016年 3月31日止 三個月	
	千美元	%	千美元	%	千美元	%	千美元	%
離散式功率								
半導體銷售	15,112	93.2	16,694	92.3	3,164	85.7	5,113	91.1
原材料貿易	1,109	6.8	1,401	7.7	528	14.3	498	8.9
總計	<u>16,221</u>	<u>100.0</u>	<u>18,095</u>	<u>100.0</u>	<u>3,692</u>	<u>100.0</u>	<u>5,611</u>	<u>100.0</u>

業 務

毛利及毛利率

截至2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月，毛利分別約為4.6百萬美元、5.2百萬美元及1.7百萬美元，毛利率分別約為28.4%、28.5%及30.0%。下表載列往績記錄期間分部毛利及毛利率：

	離散式功率半導體銷售				原材料貿易			
	截至12月31日止年度		截至3月31日止三個月		截至12月31日止年度		截至3月31日止三個月	
	2014年	2015年	2015年	2016年	2014年	2015年	2015年	2016年
	千美元	千美元	千美元	千美元	千美元	千美元	千美元	千美元
		(未經審核)				(未經審核)		
分部收入	15,112	16,694	3,164	5,113	1,109	1,401	528	498
分部毛利	4,237	4,606	940	1,488	373	558	211	198
分部毛利率	28.0%	27.6%	29.7%	29.1%	33.6%	39.8%	40.0%	39.8%

截至2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月，離散式功率半導體銷售所得毛利分別約佔毛利總額的91.9%、89.2%及88.3%，而原材料貿易所得毛利分別約佔同年毛利總額的8.1%、10.8%及11.7%。

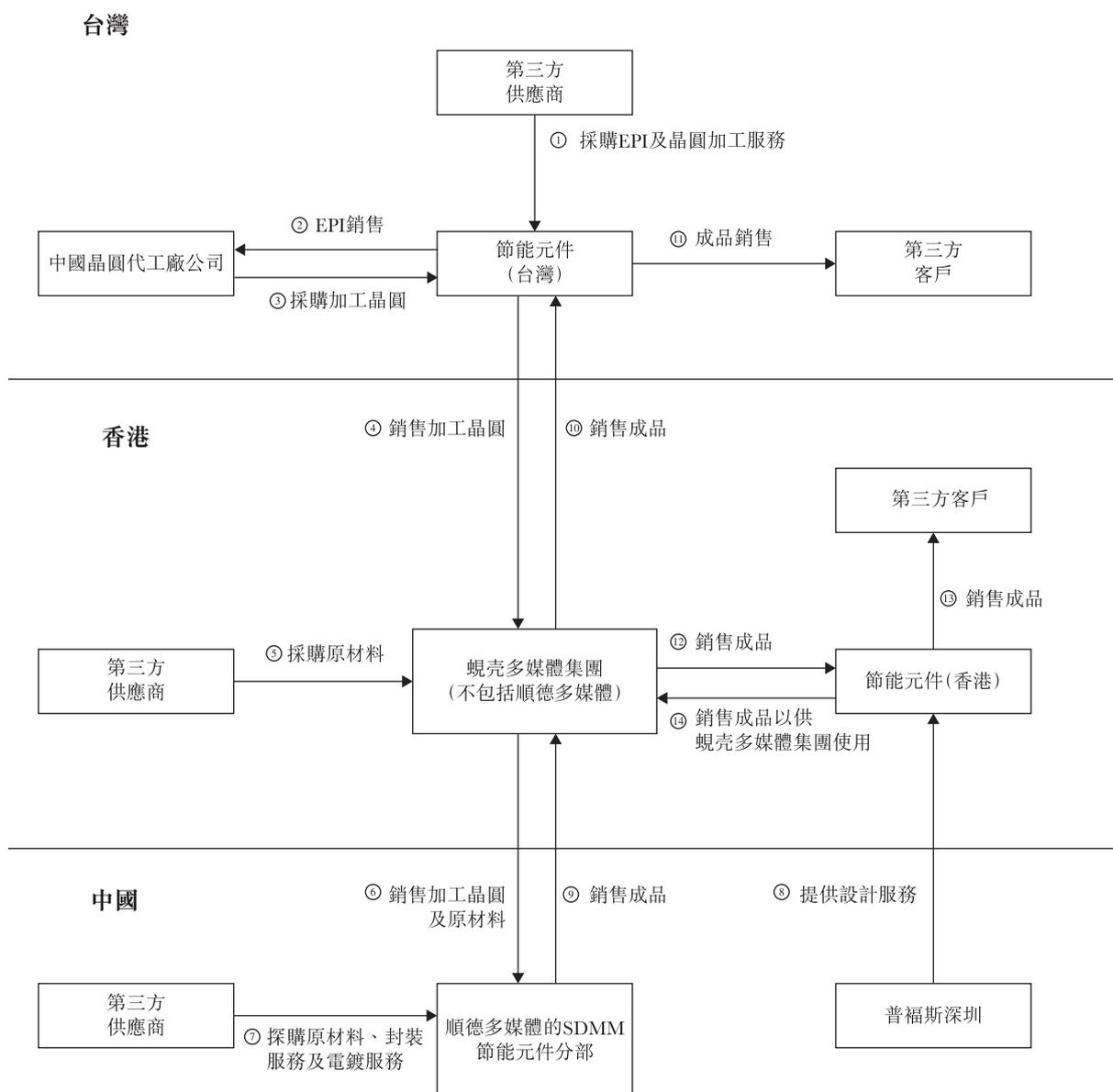
本集團原材料貿易的毛利率一般高於離散式功率半導體銷售，主要由於(i)本集團享有自EPI供應商大宗採購的成本效益；及(ii)該業務所產生的直接成本低於離散式功率半導體銷售業務。截至2015年12月31日止兩個年度各年以及截至2016年3月31日止三個月，原材料貿易的毛利率分別約為33.6%、39.8%及39.8%，而同年離散式功率半導體銷售的毛利率則分別約為28.0%、27.6%及29.1%。

業 務

資產重組前後本集團業務流的說明

資產重組前業務流

下表說明資產重組完成前本集團業務流：



業 務

程序(1)至(8)一節能元件(台灣)承攬向第三方供應商採購EPI及加工晶圓工作。截至2015年12月31日止兩個年度，所採購EPI及加工晶圓售予蜆壳多媒體集團，其繼而轉售予SDMM節能元件分部。蜆壳多媒體集團向第三方供應商採購原材料，其繼而轉售予SDMM節能元件分部。SDMM節能元件分部亦向第三方供應商採購原材料、封裝服務及電鍍服務以供生產之用。截至2015年12月31日止兩個年度，普福斯深圳向節能元件(香港)提供設計服務，其於2015年8月終止。

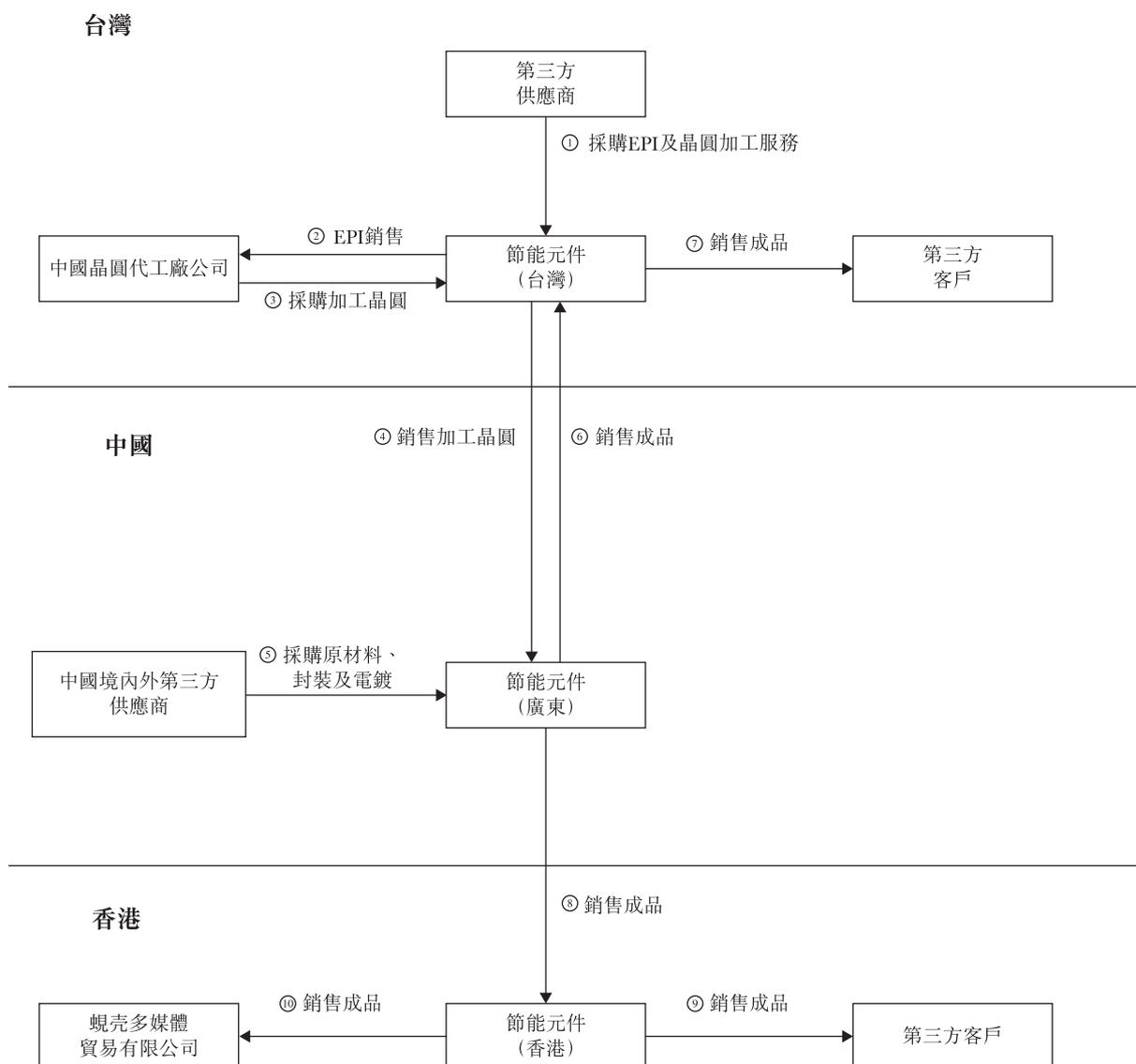
程序(9)至(13)一截至2015年12月31日止兩個年度，SDMM節能元件分部向蜆壳多媒體集團出售成品，其繼而向節能元件(台灣)及節能元件(香港)轉售，以供向第三方客戶銷售。資產重組完成後，成品由節能元件(廣東)直接售予節能元件(台灣)及節能元件(香港)，以供向第三方客戶銷售。

程序(14)一節能元件(香港)自2013年起亦向蜆壳多媒體集團(極少量由節能元件(台灣)出售)出售若干成品(即離散式功率半導體)用作彼等生產電器的原材料，截至2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月，其金額分別為數約13,000美元、16,000美元及2,000美元。節能元件(香港)向蜆壳多媒體集團出售的該等成品為用於蜆壳多媒體集團所生產吸塵機及照明產品等電器的離散式功率半導體。往績記錄期間，據董事確認，本集團的分銷商並無向蜆壳多媒體集團出售任何本集團產品。

業 務

資產重組後業務流

下表說明資產重組完成後本集團業務流：



程序(1)至(5)－節能元件(台灣)承攬向第三方供應商採購EPI及加工晶圓工作。資產重組完成後，所採購EPI及加工晶圓已售予節能元件(廣東)以供生產之用。節能元件(廣東)向第三方供應商採購原材料、封裝服務及電鍍服務。

程序(6)至(9)－資產重組完成後，成品由節能元件(廣東)售予節能元件(台灣)及節能元件(香港)，以供向第三方客戶銷售。

業 務

程序(10)一節能元件(香港)連同PFC Device Corporation或節能元件(廣東)亦向蜆壳多媒體集團出售若干成品(即離散式功率半導體)，用作彼等生產電器的原材料(該等所售離散式功率半導體用於吸塵機及照明產品等蜆壳多媒體集團所生產的電器)，而交易的進一步詳情於本文件「獲豁免持續關連交易—獲豁免持續關連交易—6. 節能元件(香港)與蜆壳多媒體貿易的框架供應協議」一節披露。

節能元件(深圳)於2015年5月18日成立為節能元件(廣東)的分支辦事處，並接替普福斯深圳角色。為免冗贅，本公司已於2015年12月著手取消普福斯深圳註冊。普福斯深圳其後於2016年6月22日取消註冊。

資產重組完成後，除本文件「獲豁免持續關連交易」一節所披露的持續關連交易外(當中涉及順德生產廠房及附屬設施、香港及深圳的營業處所的租賃以及本集團向蜆壳多媒體集團銷售離散式功率半導體)，本集團與蜆壳電器其他業務之間概無進行其他交易。

資產重組完成後，本集團的訂價、成本架構及盈利能力均並無重大變動，而本集團的訂價政策及成本架構則維持不變，因此，本集團的經營及財務業績將不會受資產重組的重大影響。

本集團產品

本集團的離散式功率半導體供電源供應器使用，應用範圍遍及多種電子器材，計有流動電話、筆記簿型電腦及LED電視等電子消費品，以至汽車及太陽能板等。本集團的離散式功率半導體主要包括可按各種封裝類型封裝的一種整流器蕭基二極管。不同封裝類型大小各異且用途不同。本集團的離散式功率半導體使用由內部研發團隊開發的自有專利元件結構及製造方法。元件結構是排列均質或多層半導體材料的裝置或安排的結構，其加工方式為控制式執行預定電子性能。本集團的離散式功率半導體應用於電源供應器，應用範圍遍及多種電子器材，達至供電節能效果，從而提高電子器材的能源效益。

截至2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月，蕭基二極管的銷售分別約達15.1百萬美元、16.7百萬美元及5.1百萬美元。

業 務

下表所載為本集團製造而於本集團旗下有售的離散式功率半導體主要封裝類型以及其各自的特性及用途：

類型	呎吋 (立方毫米)	特性	離散功能及 2015年12月31日 概約價格範圍 (每千件美元)	用途
TO-220 	28.9毫米(長) 10.50毫米(闊) 4.60毫米(高)	高能效	輸出整流器 (90美元-500美元)	個人電腦、LED電視 電源供應器
TO-247 	36.87毫米(長) 16.00毫米(闊) 5.34毫米(高)	良好功率耗散	半波整流器 (250美元-750美元)	個人電腦、電訊及 工業電源供應器
TO-277 	6.50毫米(長) 4.00毫米(闊) 1.10毫米(高)	高能效	輸出整流器 (65美元-180美元)	流動電話充電器及太 陽能板
ITO-220 	28.90毫米(長) 10.50毫米(闊) 4.60毫米(高)	良好隔離	半波整流器 (90美元-500美元)	手提電腦及LED電視 電源供應器
SMAF-A 	5.60毫米(長) 2.95毫米(闊) 1.10毫米(高)	薄型	切換及輸出整流器 (25美元-80美元)	流動電話充電器

蕭基二極管是電源供應器用二極管整流器，用途遍及多種電子器材。整流器是把交流電轉換，定期逆轉電流方向成為僅單向流動的直流電的電路電元件之一，並為電子及電器用具的常用元件。本集團的蕭基二極管產品範圍包括金氧半蕭基整流器及溝道式蕭基整流器，兩者均備有TO-220、TO-247、TO-277、ITO-220及SMAF-A的封裝類型。金氧半蕭基整流器結合傳統平面式蕭基的正向損耗較低與反向漏電流低、浪湧能力高以及隔熱性高形成的熱穩定性高的優勢。本集團溝道式蕭基整流器使用最新溝道式技術，而使其較傳統蕭基二極管正向損耗低、反向漏電流低及切換速度快。

業 務

下表所載為往績記錄期間內按封裝類型劃分的本集團主要產品蕭基二極管的收入、銷量及平均售價：

封裝類型	截至12月31日止年度								
	2014年				2015年				2014年至2015
	收入	收入%	已售件數	平均售價	收入	收入%	已售件數	平均售價	年間平均售價減幅
	千美元		千	每千件 美元	千美元		千	每千件 美元	%
TO-220	8,650	57.2%	49,942	173	9,695	58.1%	58,784	165	4.8%
ITO-220	1,989	13.2%	9,478	210	2,832	17.0%	16,834	168	19.8%
TO-277	2,235	14.8%	20,772	108	2,224	13.3%	24,820	90	16.7%
TO-247	492	3.2%	1,154	427	477	2.9%	1,668	286	32.9%
SMAF-A	404	2.7%	9,407	43	232	1.4%	6,904	34	21.9%
其他	1,342	8.9%	不適用	不適用	1,234	7.3%	不適用	不適用	不適用
總計	15,112	100.0%	—	—	16,694	100.0%	—	—	—

封裝類型	截至3月31日止三個月								
	2015年				2016年				期間平均
	收入	收入%	已售件數	平均售價	收入	收入%	已售件數	平均售價	售價減幅/ (增幅)
	千美元 (未經審核)		千	每千件 美元	千美元		千	每千件 美元	%
TO-220	1,931	61.1%	10,728	180	3,085	60.4%	18,379	168	6.8
ITO-220	573	18.1%	3,034	189	1,202	23.5%	7,046	171	9.6
TO-277	300	9.5%	2,810	107	280	5.5%	3,699	76	29.2
TO-247	165	5.2%	636	259	99	1.9%	366	272	(4.9)
SMAF-A	17	0.5%	310	55	7	0.1%	178	42	24.1
其他	178	5.6%	不適用	不適用	440	8.6%	不適用	不適用	不適用
總計	3,164	100.0%	—	—	5,113	100.0%	—	—	—

附註：截至2015年12月31日止年度以及截至2016年3月31日止三個月的其他收入包括MOSFET產生的極小額收入。

如「行業概覽—半導體市場需求及增長前景」一節所分析，根據Prismark，全球離散式半導體市場平均售價於2011年至2015年間有所下降（2015年全球半導體市場整體平均售價下降約6%），估計將於2016年至2020年間進一步下降。中國離散式半導體市場的平均售價於2011年至2015年間有所下降（2015年中國半導體市場整體平均售價下降約7%），估計將於2016年至2020年間企穩。

業 務

董事認為，半導體市場定價具透明度，而本集團產品的平均售價受市價波動趨勢影響。

如上表所示，2015年本集團離散式功率半導體主要封裝類型平均售價較上一年度降價約4.8%至32.9%，而於截至2016年3月31日止三個月則較上年同期減少約6.8%至29.2%（封裝類型TO-247除外）。

各離散式功率半導體封裝類型中包括特色、規格及大小各異的不同型號，因而售價各有不同。因此，所出售的某封裝類型不同數量的不同型號（亦即產品組合）將對該封裝類型於不同年度的整體平均售價影響深遠。

董事認為，本集團的離散式功率半導體各主要封裝類型的平均售價跌幅高於全球離散式半導體市場整體跌幅的原因如下：

- 往績記錄期間，按收入計，TO-220封裝類型作為本集團最主要離散式功率半導體類型，分別約佔截至2015年12月31日止兩個年度及截至2016年3月31日止三個月離散式功率半導體銷售收入的57.2%、58.1%及60.4%，2015年，該封裝類型平均售價較上一年度下跌約4.8%，而截至2016年3月31日止三個月則較上年同期減少約6.8%，大致與全球及中國離散式半導體市場一致；
- ITO-220封裝類型分別約佔截至2015年12月31日止兩個年度及截至2016年3月31日止三個月離散式功率半導體銷售收入的13.2%、17.0%及23.5%，儘管該封裝類型於2015年的平均售價較上一年度下跌約19.8%，而截至2016年3月31日止三個月則較上年同期減少約9.6%，惟可見ITO-220封裝類型的個別型號整體平均售價減幅於2015年介乎約5%至9%不等，而截至2016年3月31日止三個月個別型號平均售價變動率則同時有所增加及減少。該封裝類型整體平均售價減幅較高（其中以2015年尤其顯着），主要原因在於售價較低的若干型號在2015年／截至2016年3月31日止三個月較上一年度／上年同期售出較多件數，故產品組合有變；
- TO-277封裝類型分別約佔截至2015年12月31日止兩個年度及截至2016年3月31日止三個月離散式功率半導體銷售收入的14.8%、13.3%及5.5%，該封裝類型於2015年的平均售價較上一年度下跌約16.7%，而截至2016年3月31日止三個月

業 務

則較上年同期減少約29.2%。董事認為，TO-277封裝類型為較新封裝類型，主要以流動電話市場為目標，相對其他封裝類型，面對競爭導致的平均售價跌幅較大；

- TO-247封裝類型分別約佔截至2015年12月31日止兩個年度及截至2016年3月31日止三個月離散式功率半導體銷售收入的3.2%、2.9%及1.9%，該封裝類型於2015年的平均售價較上一年度下跌約32.9%，而截至2016年3月31日止三個月則較上年同期增加約4.9%。董事認為，該封裝類型於2015年平均售價減幅較高，主要由於(i)本集團拓展該封裝類型市場的策略；及(ii)售價較低的若干型號在2015年售出，而上一年度則並無出售有關型號，故產品組合有變，而於截至2016年3月31日止三個月的平均售價攀升則主要由於產品組合變動所致，原因在於截至2015年3月31日止三個月所售而售價較低的某一型號於截至2016年3月31日止三個月未有錄得銷售；及
- SMAF-A封裝類型分別約佔截至2015年12月31日止兩個年度及截至2016年3月31日止三個月離散式功率半導體銷售收入的2.7%、1.4%及0.1%，該封裝類型於2015年的平均售價較上一年度下跌約21.9%，而截至2016年3月31日止三個月則較上年同期減少約24.1%。董事認為，SMAF-A封裝類型是較新的封裝類型，相對其他封裝類型，因競爭而導致平均售價減幅較大。

本集團的離散式功率半導體可以不同封裝類型發售，當中包括本文件「行業概覽」一節所討論的四代封裝。本集團將不時檢討封裝類型的市場需求，並以其他恰當封裝類型擴大其有售的離散式功率半導體。本集團可向外聘封裝公司分包新封裝類型離散式功率半導體的封裝，而一旦銷量上升並建立需求，則於內部進行該等封裝類型的封裝流程。截至2015年12月31日止兩個年度，以第四代封裝進行封裝的離散式功率半導體的銷售分別約為5,400美元及零。自2016年1月1日至最後實際可行日期期間的以第四代封裝進行封裝的離散式功率半導體銷售約達300美元，於最後實際可行日期，該等半導體並無來自客戶的已確認銷售合同、意向訂單及／或要求。所有該等離散式功率半導體均售予浩陽半導體股份有限公司及凱恩傑科技股份有限公司，彼等特別要求相關蕭基整流器/MOSFET以第四代封裝類型DFN封裝進行封裝。就本集團所售的該等離散式功率半導體第四代封裝而言，封裝流程全部向外聘封裝公司外判。

業 務

然而，離散式半導體市價整體降幅的影響因製造成本下降得以緩和，有關分析載於「行業概覽—離散式半導體封裝原材料及成本結構」一節。儘管2015年本集團產品平均售價較上一年度下降，截至2015年12月31日止兩個年度，本集團一直可維持其離散式功率半導體業務銷售的毛利率於28%，董事認為，主要由於本集團有效控制其供應商的材料成本。截至2016年3月31日止三個月，銷售離散式功率半導體業務的毛利率約為29.1%，略低於上年同期約29.7%。

2015年，本集團完成開發其首個MOSFET（一種晶體管）產品型號。MOSFET是多種電子器材電源供應器的整流器用晶體管。本集團的MOSFET現正處於建立產品組合階段，MOSFET產品範圍包括同步整流器MOSFET、高伏MOSFET及超接面MOSFET，特色為耐壓性較高、導通電阻較低，以取得切換速度與導通電阻之間的理想平衡。MOSFET是建基於業內精密及廣受認同技術的一種標準類型晶體管，與本集團直接用家／最終用家的產品兼容，並常與蕭基二極管等其他離散式半導體一併使用。根據Prismark，MOSFET在2015年售出的48十億件功率晶體管中分佔約75%或36十億件。2011年至2015年間，MOSFET按複合年增長率約2%增長，並預測將於2016年至2020年間按複合年增長率約5%增長。有關MOSFET及其市場的進一步詳情，請參閱本文件「行業概覽—MOSFET市場概覽」一節。本集團的MOSFET現正處於建立產品組合階段，而本集團將繼續其研發工作，（其中包括）以開發更多不同規格的MOSFET產品型號，藉此擴大MOSFET的產品組合。董事認為，長遠而言，在建立MOSFET的產品組合以及生產規模後，本集團MOSFET產品的利潤率應與本集團蕭基二極管產品相若。根據前文所述，董事相信，擴展有售產品至MOSFET將允許本集團發揮MOSFET的增長潛力，並對本集團長遠財務表現作出貢獻。

本集團亦從事原材料（即EPI）貿易業務。本集團採購EPI作為其主要原材料，該半導體材料為生產加工晶圓的核心原材料。本集團出售其部分EPI予中國晶圓代工廠公司（位於中國深圳的晶圓代工廠，於往績記錄期間內為本集團五大供應商之一），本集團再向其採購可以本集團所售同類EPI生產的加工晶圓，並為截至2016年3月31日止三個月本集團五大客戶之一。有關往績記錄期間中國晶圓代工廠公司以及內本集團與中國晶圓代工廠公司的交易的進一步詳情，請參閱本文件「業務—客戶—原材料貿易」一節。

業 務

生產設施及產能

生產設施

本集團在順德生產廠房經營生產活動。順德生產廠房位於中國廣東順德，佔地約總建築面積5,160平方米。本集團自順德多媒體租用順德生產廠房，租期自2015年10月1日起至2017年9月30日止。順德生產廠房由生產區及辦公區組成。有關本集團租賃物業以及就相關租賃安排的持續關連交易的進一步詳情，請參閱本文件「業務—物業—租賃物業」及「獲豁免持續關連交易」兩節。下表所載為順德生產廠房的建築面積詳情：

	<u>建築面積</u> (平方米)
生產範圍	4,160
辦公室範圍	<u>1,000</u>
總計	<u><u>5,160</u></u>

生產設備

最後實際可行日期，本集團擁有順德生產廠房所有生產設備。本集團生產流程所用主要設備為(i)晶圓測試、分類及分離用晶片針測機及晶粒切割機；(ii)固晶及線焊晶粒至導線架的固晶機及線焊機；(iii)覆晶及分離用壓模機及修邊機；及(iv)測試成品的測試機。有關本集團生產流程的進一步詳情，請參閱本文件「業務—生產流程」一節。下表所載為往績記錄期間本集團主要離散式功率半導體封裝類型的生產設備的產能上限、實

業 務

實際產量及利用率的資料：

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月		
	2014年			2015年			2016年		
	產能上限 (附註1)	實際 產量	平均 利用率 (附註2及3)	產能上限 (附註1)	實際 產量	平均 利用率 (附註2及3)	產能 上限 (附註1)	實際 產量	平均 利用率 (附註2及3)
千件	千件	%	千件	千件	%	千件	千件	%	
晶圓測試及分類 (附註4及5)：	220,440	155,003	70.3	207,240	170,523	82.3	52,140	31,155	59.8
封裝： (晶粒切割)	169,004	157,841	93.4	238,326	190,321	79.9	59,961	42,684	71.2
TO220/ITO220 /TO277/TO247									
(固晶)	94,422	90,279	95.6	145,402	107,401	73.9	42,290	31,063	73.5
(線焊)	93,687	88,509	94.5	132,878	106,753	80.3	42,320	30,843	72.9
SMAF-A (固晶及線焊)	—	—	—	82,896	6,890	8.3	20,856	298	1.4
產品測試 (附註4)：									
1. TO220/ITO220	73,480	63,328	86.2	105,050	78,132	74.4	34,760	27,247	78.4
2. TO277	49,232	21,587	43.8	79,301	26,940	34.0	23,289	3,888	16.7
3. TO247	1,540	596	38.7	17,270	1,609	9.3	4,345	407	9.4
4. SMAF-A	—	—	—	46,284	6,520	14.1	11,645	267	2.3

附註：

1. 年產能上限按(i)各設備的設計日產能；及(ii)截至2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月分別為334、314及79個操作日計算。
2. 儘管截至2015年12月31日止年度的TO220/ITO220/TO277/TO247封裝類型半導體實際產量較截至2014年12月31日止年度上升，產能上限的增幅較大，原因在於添置新生產設備，以及從而導致產能上限增加，因而導致晶粒切割、固晶及線焊的有關生產設備利用率較低。
3. 截至2014年12月31日止年度，SMAF-A封裝類型半導體的封裝流程完全向外聘封裝公司外包。SMAF-A半導體生產設備主要於2015年上半年調試，而SMAF-A半導體生產於2015年下半年攀升，其相當於2015年SMAF-A半導體已售單元的90%以上，因而導致固晶及線焊以及產品測試的有關生產設備利用率較低。

業 務

4. 就產品測試而言，本集團對其成品進行100%測試，而離散式功率半導體各主要封裝類型的實際產品測試數量則相當於該產品的實際產量。
5. 取決於產品規格，一件離散式功率半導體可能包括一或兩件晶粒，即所測試晶圓晶粒數目高於所生產離散式功率半導體數目。因此，晶圓測試及分類機器的產能訂於高於其他生產機器的產能。

截至2015年12月31日止年度，本集團主要離散式功率半導體封裝類型的生產設備的實際產量較上一年度增加，主要由於藉添置全新生產設備擴充產能。

截至2015年12月31日止兩個年度，TO-220、ITO-220、TO-277及TO-247半導體封裝類型的已售件數合計分別約為81,000,000件及102,000,000件，於各年度，與該等封裝類型半導體的線焊（作為主要封裝流程之一）分別約為89,000,000件及107,000,000件的實際產量一致。截至2015年12月31日止兩個年度，TO-220、ITO-220、TO-277及TO-247半導體封裝類型已售件數中不足3%的封裝流程外包予外聘封裝公司。

就SMAF-A半導體封裝類型而言，截至2014年12月31日止年度，所有已售件數封裝流程均外判予外聘封裝公司，而由於本集團就2015年起投產的SMAF-A半導體封裝購置生產設備，截至2015年12月31日止年度，本集團於順德生產廠房進行的封裝流程達已售件數中90%以上。

就其他半導體封裝類型（TO-220、ITO-220、TO-277、TO-247及SMAF-A主要封裝類型除外）而言，截至2015年12月31日止兩個年度的該等已售件數的封裝流程外判予外聘封裝公司。

截至2015年12月31日止兩個年度，年內所售的約25.5%及14.6%的功率半導體的封裝流程外包予外聘封裝公司。若干封裝類型的封裝流程外包予外聘封裝公司，原因在於該等封裝類型一般屬本集團新面市而銷量較低。經考慮生產的成本效益及所需完成時間，本集團向外聘封裝公司外判該等封裝類型的封裝流程。一旦銷量上升並建立需求，本集團將於計及資本開支及人力資源需求後決定是否內部進行該等封裝類型的封裝流程。本集團的離散式功率半導體可以不同封裝類型發售，當中包括本文件「行業概覽」一節所討論的四代封裝。本集團將不時檢討封裝類型的市場需求，並以其他恰當封裝類型擴充其有售的離散式功率半導體。有關本集團封裝流程的進一步詳情，請參閱本文件「業務—生產流程—封裝」一節。

業 務

本集團設有內部工程團隊管理及維護本集團設備。工程團隊負責主管設備安裝並進行質量檢測，並與設備供應商聯絡以確保所採購設備符合本集團規定的規格及標準。工程團隊亦監察設備，並確保生產線配合生產流程優化。本集團內部工程團隊在需要時可制訂生產線所需適應調整，安排於短時間內生產不同封裝類型的離散式功率半導體。

本集團工程團隊為本集團的設施及設備進行定期維護，並維修及定期檢查設施及設備。本集團對旗下設備進行例行清潔及維護，以維持營運效率並延長設備的使用期。本集團亦進行每年大型設備維護工作。往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本集團生產設施概無任何重大中斷。

截至2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月，本集團分別就添置物業、廠房及設備(當中主要包括採購設備及機器)產生資本開支約2.7百萬美元、4.3百萬美元及0.1百萬美元。按本集團設備估計最高可使用年期10年計算，本集團不預期其設備將於短期內有任何重大重置開支。

生產人員

於最後實際可行日期，本集團於順德生產廠房有合共94名僱員。下表載列本集團於最後實際可行日期在順德生產廠房的僱員詳情：

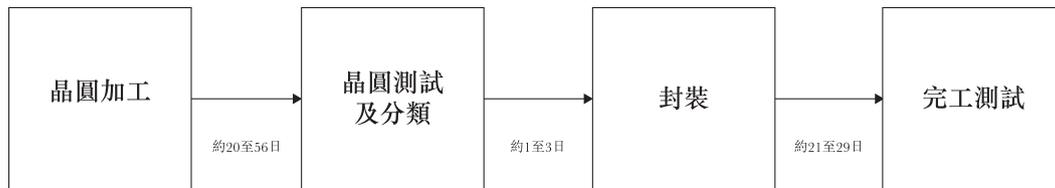
人員種類	
生產線工人	68
質控人員	5
工程師	5
其他	16
	<hr/>
總計	94

本集團計劃通過增購設備擴充產能及封裝類型範圍。有關擴充本集團現有生產線及設立新生產線的執行計劃的進一步詳情，請參閱本文件「業務—業務策略」以及「業務目標及所得款項用途聲明—執行計劃」各節。

業 務

生產流程

本集團在生產流程中參與離散式功率半導體的封裝及測試。下表說明離散式功率半導體製造流程所涉及的主要步驟：



蕭基二極管及MOSFET的生產流程及所需時間相若。向晶圓代工廠外包的晶圓加工一般需時約20至56天完工。在順德生產廠房進行的晶圓測試及分類、封裝及測試(包括向外聘電鍍廠外包的電鍍流程)，一般需時約21至29天完工。一般而言，離散式功率半導體自晶圓加工至完工測試的生產流程需時約6至12周完工。

晶圓加工

半導體材料為離散式半導體所採用的核心原材料，其電性經改動，以使離散式半導體可運行電子器材所需性能。本集團離散式功率半導體所使用的半導體材料為以硅為基材的EPI。晶圓加工為涉及一系列微加工程序的複雜程序，當中包括光刻、離子佈植、金屬沉積及化學加工，元件在該流程中以半導體材料晶圓製造。在晶圓加工流程中，在同一晶圓上建構大量普遍稱為晶粒的獨立元件。一般而言，本集團所用的一般直徑介乎6至8吋的圓形片狀單一晶圓上含900至10,000晶粒。

在晶圓上建構的元件結構建基於本集團旗下專利設計。本集團開發的設計允許更密集封裝(即更高效利用半導體材料)，從而在採用某一特定封裝方式時，其離散式半導體性能將勝於其他離散式半導體。

晶圓代工廠使用先進設備進行微加工程序，而元件則在晶圓上建構。晶圓加工為複雜操作，需要特殊設備及涉及複雜精細流程，因此，設立晶圓加工專用設施屬高度資本密集。有見於上述各項，本集團向晶圓代工廠外判晶圓加工流程。

往績記錄期間，本集團向位於台灣的兩間晶圓代工廠，同時亦向位於中國的中國晶圓代工廠公司外判晶圓加工流程，以生產其所有離散式功率半導體，彼等均為獨立第三方，並已分別與本集團建立約三年、四年及四年業務關係。往績記錄期間內，本集團亦

業 務

根據中國晶圓代工廠公司業務慣例向其出售EPI。有關往績記錄期間內中國晶圓代工廠公司以及本集團與中國晶圓代工廠公司之間的交易的進一步詳情，請參閱本文件「業務—客戶—原材料貿易」一節。

晶圓加工的晶圓代工廠乃計及產能、產品質量、可靠性及價格等因素後選用。本集團亦已委聘多名按類似條款向本集團提供晶圓加工服務的替補晶圓代工廠。往績記錄期間，本集團與晶圓代工廠訂立無採購承諾的長期框架協議，協議期自一至五年，於屆滿時可自動續期／經雙方協定連續續期。

在晶圓加工流程中，元件根據本集團轉交晶圓代工廠的電路結構專利設計在晶圓上建構。本集團已與各晶圓代工廠訂立保密協議以保障本集團知識產權。有關本集團專利的進一步詳情，請參閱本文件附錄四「B.有關本集團業務的進一步資料—2.知識產權」一段。於最後實際可行日期，本集團並無獲悉本集團擁有的任何知識產權有任何侵權事項。

晶圓測試及分類

由晶圓代工廠生產的晶圓其後發送至順德生產廠房。本集團設置晶片針測機，即以軟件程式輔助進行自動化晶圓測試的測試機。就每一測試晶圓而言，每一晶圓上的每一晶粒均按預設參數測試事先釐定的性能，確保每一晶粒均按要求規格運作。凡晶粒未能通過測試的，視為欠妥並由測試機標上記號，並將於其後的分類流程中被篩出。每塊晶圓的良率（即一塊晶圓上通過測試的晶粒比率）於測試過程中進行記錄。按董事確認，與業內標準一致，本集團一般要求晶圓代工廠的晶圓良率最少達80%。本集團毋須就低於規定良率的任何欠妥晶圓付款。

經測試晶圓其後由本集團晶粒切割機切割為獨立晶粒。任何已標記號欠妥晶粒將於該流程中被篩出，且將不會在生產流程中採用。監察測試及分類全流程的人員由本集團指定。

封裝

封裝為半導體晶粒作工為成品加離散式半導體的一系列流程。本集團於順德生產廠房進行大部分封裝流程，並向外聘封裝商外判若干封裝類型的離散式功率半導體的電鍍流程及封裝流程。截至2015年12月31日止兩個年度，年內所售的約25.5%及14.6%的功率半導體的封裝流程外包予外聘封裝公司。若干封裝類型的封裝流程外包予外聘封裝公司，原因在於該等封裝類型一般屬本集團新面市而銷量較低。經考慮生產的成本效益及所需完成時間，本集團向外聘封裝公司外判該等封裝類型的封裝流程。一旦銷量上升並

業 務

建立需求，本集團將於計及資本開支及人力資源需求後決定是否內部進行該等產品的封裝流程。主要封裝步驟一般包括個別晶粒以成型壓料覆晶成型作保護、封裝晶粒鍍鋅膜並建構電子接點，以供封裝晶粒黏接及應用於選定電子元件／單元。MOSFET的封裝大部分可由封裝蕭基二極管的生產設備進行。下文所載為封裝流程的概要說明：

固晶及線焊

晶粒使用全自動固晶機使用軟焊料固定於導線架。鋁線其後以線焊機焊接晶粒電極與導線架之引腳。

黏晶及去膠

封膠其後黏著至各已固定晶粒，以保護其免受機械、化學及環境損壞。進行去膠操作以修邊及除去導線架上因黏晶而積聚的任何多餘黏晶化合物。

電鍍

有關元件其後進行電鍍工序，工序中以鋅膜覆蓋表面。往績記錄期間，本集團向一間位於中國廣東深圳的電鍍廠外判電鍍流程，以生產其所有離散式功率半導體，該廠為獨立第三方。向外聘特種電鍍廠外包電鍍流程的理由計有（其中包括）(i)電鍍業務在污染方面在中國備受嚴格規管，而遵照相關環境法規營運成本高昂；及(ii)經營電鍍業務所需專業知識與半導體生產極為不同。由於前文所述，本集團內部進行電鍍流程並不符合經濟效益。

電鍍廠經考慮產能、產品質量、可靠性及價格等因素後選用。本集團亦已物色按類似條款向本集團提供電鍍服務的替補電鍍廠。往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本集團並無與任何電鍍廠訂立任何長期分包協議。

修邊成形

電鍍後，元件其後分離成形（如必要，視乎封裝類型）為獨立半導體零件成品。

測試、標記號及黏膠帶

完工測試的進行是為確保半導體成品符合要求性能規格。各半導體成品均進行測試，而測試為以軟件輔助的測試設備進行的自動化流程。經測試半導體其後激光

業 務

打標，在各半導體成品上刻上公司及產品識別號。視乎半導體成品的封裝，已標記號半導體其後載入至管狀或帶狀載子，以便封裝。

完工檢測及封裝

裝載半導體成品的各載體在封裝前由專責質控人員經工人協助進行檢測。經檢測載體將封裝並附上產品說明標籤，並載入溫濕控貨倉備妥以供裝運。

本集團亦向外聘封裝商外判若干離散式功率半導體的若干封裝類型的封裝流程。截至2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月，由外聘封裝商進行封裝的外包成本分別約為668,000美元、327,000美元及124,000美元。

質控及認可

概覽及認可

如上文「業務—競爭優勢」一節所討論，本集團的競爭優勢之一為作為優質離散式功率半導體製造商的美譽，有關美譽有賴本集團在生產流程內不同工序實施嚴格質量控制達成。

於最後實際可行日期，本集團質控部由3名高級質控人員組成，負責監督本集的質控制度，當中2名為TS 16949系列的認可內部審查員。本集團的質控人員平均行業經驗約達20年。

PFC Device Corporation於2009年取得ISO 9001:2008國際認可質量管理體系認證。節能元件(廣東)於2015年取得ISO 9001:2008以及TS 16949:2009(兩者均為國際認可質量管理體系認證)。

本集團產品的若干最終用家為品牌電子消費品知名製造商，彼等亦對本集團的生產設施及管理體系進行質量審核。

製造流程質量控制

本集團指定專責質控人員，彼等在工人協助下監察各生產工序。除於晶圓分類工序及完工測試工序進行自動化測試外，質控人員亦於其他生產工序對原材料、半成品及成品進行取樣測試。該等質控措施旨在維持本集團產品質量及低不良率。

業 務

就原材料／服務的質控而言，本集團存置認可供應商及分包商名單，以供本集團選用作原材料／服務採購。該等供應商及分包商基於（其中包括）材料／服務質量往績、交貨準時性、可靠度及產能等因素入選該認可名單。本集團要求其供應商／分包商於交付原、加工材料前提供質量核查報告。本集團就質量及是否符合規格要求取樣檢驗原／加工材料。具體而言，就半導體所使用的主要原材料加工晶圓而言，就每塊測試晶圓而言，由晶圓代工廠供應的各加工晶圓的每一晶粒均按預設參數測試事先釐定的性能。凡晶粒未能符合要求規格的，將於其後的分類流程中被篩出而不會用於生產。

本集團指定專責質控人員，彼等在工人協助下監察各生產工序，確保符合相關質控要求。進行包括但不限於晶粒切割、固晶、線焊及封膠等各主要封裝工序後，半成品進行外觀檢查及／或以測試機測試性能，確保符合本集團質量標準。作為製造流程的最終步驟，完工測試的進行是為確保離散式功率半導體成品符合要求性能規格。各離散式功率半導體成品均進行測試，而測試為以軟件輔助的測試機器進行的自動化流程。已裝載至載體的半導體成品於封裝前由專責質控人員經工人協助再次檢測，並備妥以供裝運。

銷售及營銷

銷售市場

本集團產品出售至中國、台灣及其他亞洲地區市場。本集團在台灣及香港營運銷售辦事處，銷售後勤辦事處則位於中國深圳。台灣銷售辦事處監督本集團的銷售及營銷業務。

下表所載為本集團的收入於往績記錄期間按分銷地區劃分的地域詳情：

	截至2014年		截至2015年		截至2015年		截至2016年	
	12月31日止		12月31日止		3月31日止		3月31日止	
	年度		年度		三個月		三個月	
	千美元	%	千美元	%	千美元	%	千美元	%
台灣	6,744	41.6	7,649	42.3	1,740	47.1	2,616	46.6
中國(附註 1)	8,267	51.0	9,662	53.4	1,835	49.7	2,764	49.3
亞洲，中國及台灣 除外(附註 2)	1,210	7.4	784	4.3	117	3.2	231	4.1
總計	16,221	100.0	18,095	100.0	3,692	100.0	5,611	100.0

附註：

1. 包括(i)向中國晶圓代工廠公司銷售EPI；及(ii)向蜆壳多媒體集團銷售離散式功率半導體。
2. 亞洲區(中國除外)所得收入主要來自向韓國分銷商的銷售。

業 務

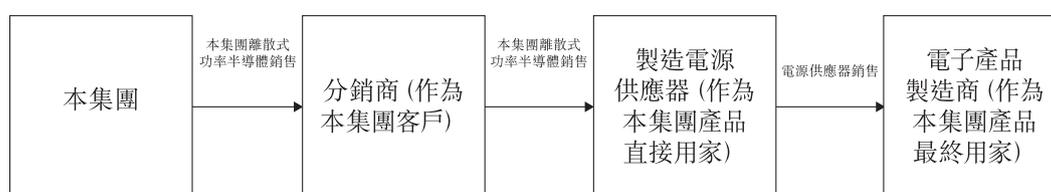
銷售及分銷渠道

分銷商

本集團客戶主要為分銷商，彼等繼而轉售本集團的半導體產品予本集團產品的直接用戶，即主要為電源供應器製造商，電源供應器將於其後用於多種電子器材。本集團與分銷商的關係屬賣方／買方關係。電源供應器可能包括多種不同電子元件，當中包括離散式功率半導體，而採購流程可能成本高昂而耗時。

就董事所深知，電子單元（包括電源供應器）製造商委聘分銷商進行採購流程實屬市場慣例。本集團客戶（作為分銷商）集中採購生產電源供應器用原材料及元件，促進及時及高效採購。

下圖說明本集團與本集團產品最終用戶之間的典型價值鏈：



本集團的分銷商為非獨家分銷商，而除出售本集團產品外，分銷商亦可出售其他國內外半導體製造商的品牌產品。下表所載為分銷商數目連同分析：

	截至2014年 12月31日止年度	截至2015年 12月31日止年度	截至2016年3月 31日止三個月
期初分銷商總數	16	13	14
期內下達採購訂單的分銷商總數	17	15	14
當中，期內：			
本集團新聘用分銷商數目	1	2	0
本集團將終止聘用分銷商數目	4	1	0
期末分銷商總數	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>14</u>

業 務

於最後實際可行日期，本集團維持業務往來關係以銷售離散式功率半導體的分銷商自2016年3月31日的14名分銷商新增兩名分銷商至16名分銷商，即本集團自2016年1月1日至最後實際可行日期期間錄得向該16名分銷商的銷售。

根據期初分銷商總數以及本集團停用的分銷商數目，截至2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月，分銷商流失率分別約為25%、18%及零。本集團不時評核分銷商是否足夠，並管理其聘用的分銷商組合。倘若某分銷商的分銷協議被終止，本集團將要求該被停用分銷商的繼任分銷商購買由被停用分銷商持有的任何未售本集團產品。

下表所載為於2014年及2015年12月31日以及2016年3月31日本公司按分銷位置劃分的分銷商數目：

	<u>2014年12月31日</u>	<u>2015年12月31日</u>	<u>2016年3月31日</u>
分銷商數目			
台灣	6	5	5
中國	6	8	8
亞洲，中國及台灣除外	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
總計	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>14</u>

就董事所深知，本集團為獲認可供應商，名列作為本集團產品最終用家的若干品牌電子產品知名製造商的認可供應商名單。本集團離散式功率半導體的最終用家以品牌電子消費產品製造商為主，彼等的產品行銷全球，包括但不限於下文所述：

- 環球品牌電子儀器生產商，包括但不限於流動電話及顯示裝置；
- 環球個人電腦生產商及企業電腦解決方案提供商；及
- 品牌電腦硬件部件及電子儀器生產商。

本集團與該等最終用家已維持超過三至六年的業務關係。凡該等所採購零件將於該等最終用家產品最終採用的，作為分銷商的本集團客戶，將僅向本集團等名列最終用家認可供應商名單的認可供應商採購元件，以供以電源供應器製造商為主的本集團產品直接用家應用。

業 務

為成為名列最終用家認可供應商清單的認可供應商，本集團一般須通過本集團生產設施的產品質量評核及質量審核。該等申請及評審手續由本集團產品的直接用家或直接用家聯同最終用家進行。除非本集團未能改正其產品已發現的任何嚴重質量問題，否則可保留認可供應商地位。往績記錄期間，本集團概無因質量或產品欠妥而被分銷商大量退貨／換貨。

如本文件「業務—客戶—離散式功率半導體銷售」一節所討論，本集團的銷售團隊與本集團的分銷商合作以推廣本集團的產品，包括產品培訓及簡報，並與最終用家合作為本集團產品取得認證及成為最終用家的認可供應商。除本集團銷售團隊的工作外，董事認為，本集團的產品吸引最終用家，原因在於(i)本集團的離散式功率半導體使用其本身專利元件結構及製造方法，可讓性能更佳，其進一步詳情載於本文件「業務—研發」一節；(ii)本集團產品的質量及可靠性，本集團已就此通過本集團產品若干最終用家(包括品牌電子消費產品知名製造商)進行的質量審核；(iii)本集團產品的可靠性繫於其嚴格質控制度，往績記錄期間，本集團產品概無因質量或產品欠妥被分銷商大量退貨／替換；及(iv)本集團產品在其客戶及最終用家間確立的美譽，由本集團與其各大客戶已維持六年以上的業務關係可見一斑。

分銷協議

一般而言，本集團與各分銷商訂立具法律約束力非獨家分銷協議，以規管本集團產品於特定地區的分銷。下文所載為典型分銷協議的主要條款。

協議年期、重續及終止

分銷協議的年期一般自協議日期起計一年。按協議訂約方協定的條款，分銷協議每年重續一年。

協議初始年期後，各訂約方可因重大違約藉發出30天的書面通知，終止分銷協議。凡有任何補救行動改正重大違約的，必須於該終止生效前自接獲該等書面通知起計30日內採取。

於發生以下事項時(其中包括)，分銷協議亦應無須事先通知予以終止(i)任何無力償債方提起或面臨財產接管或破產法律程序或結算任何一方債務的任何其他法律程序時；(ii)任何一方為債權人利益而作出指讓時；及(iii)任何一方解散時。

業 務

分銷商責任

根據分銷協議條款，分銷商於指定地區獲委任為本集團非獨家分銷商。除分銷協議另有指明者外，分銷商及其客戶之間訂立的所有銷售、租賃及／或其他協議由分銷商負全責，並一概不應影響分銷協議下的分銷商義務。分銷商應自費負責本集團產品在貿易展會及／或展覽時的廣告及推廣。

分銷商須以本集團要求的事先設定方式向本集團出具若干每月銷售報告(銷售點／購買點／存貨及取樣追蹤報告)。分銷商亦須在一年中的特定時間向本集團提供年度銷售計劃，包括銷售預算。年度銷售目標載於分銷商應盡最大努力達成的銷售預算。此外，分銷商須每月發出預測未來四個月採購的滾動採購預測。分銷商一般須下達滿足首月滾動預測100%，以及最少滿足次月滾動預測50%的採購訂單。分銷協議項下概無任何陳舊存貨安排。

分銷協議期內，分銷商須計及其客戶對本集團的產品需求，並維持本集團產品的合理存貨量作為備用存貨。本集團一般要求其分銷商維持兩個月的存貨，即存貨水平足以應付分銷商的客戶在兩個月內的需求。

交易程序

就每宗採購而言，分銷商應參照相關分銷協議下達採購訂單，包括(當中包括)(i)產品識別號；(ii)採購數量；(iii)單價；(iv)付運日期；及(v)船務及發票指示。本集團應於接獲採購訂單後兩個營業日內向分銷商書面確認接納採購訂單，並確認交貨時間表。

分銷商一般有權於交付時間前五週，通過向本集團發出正式通知，重訂時間或取消採購訂單，否則本集團有權拒絕重訂時間／取消。

本集團根據採購訂單向分銷商交付產品時，本集團確認收入。

採購訂單條款

所有購買價均應由本集團釐定，並可按市況不時修訂。購買價基準為離岸價(FOB)。分銷商應負責繳納進行交易所在國家的政府機關所評任何稅款、關稅或徵費。

業 務

信貸期

本集團向其分銷商提供的信貸期一般為交付月份後30日至60日。

退貨及保修

分銷商有權退回本集團產品的任何欠妥單元，而本集團須為分銷商免費替換欠妥單元，並承擔任何相關成本。分銷商應於有關發現後兩個營業日內將任何已發現欠妥之處知會本集團。

本集團保證，向分銷商及其客戶交付的產品將100%適合使用。分銷商須向其客戶取得批准，確保合乎規格並適合作該客戶用途。往績記錄期間，本集團產品概無被分銷商因質量或產品欠妥而重大退貨／替換。除上文所述者外，概無其他退貨政策。

對本集團分銷商的控制

本集團銷售團隊密切管理本集團分銷商，並不時取得有關分銷商供貨客戶的資料，以確保本集團分銷商之間概無競爭，即多名分銷商（主要為電源供應器製造商）向同一本集團產品直接用家售貨。倘若發現競爭，本集團銷售團隊將聯繫分銷商以解決有關競爭，舉例而言，通過指示一名分銷商停止為某一特定客戶採購，從而確保該名本集團產品直接用家不會由本集團的兩名分銷商售貨。

本集團對分銷商使用本集團的知識產權有控制權。往績記錄期間，本集團並無獲悉本集團知識產權被他人侵權的任何事件，以致對本集團業務造成重大不利影響。

訂價策略

本集團銷售部負責制訂本集團產品的售價。為其產品訂價時，本集團將參照屬性（包括但不限於規格及性能）相若的產品的通行市價。本集團產品訂價計及的其他因素亦將包括將產生的利潤率，分銷地域及訂單規模。

研發

本集團的研發團隊負責產品性能改良、新產品及技術開發以及給予銷售團隊的技術支援。大部分團隊成員具備任職上市半導體公司的過往工作經驗。其具備設計及開發產品的技術知識及行業訣竅，有助增加產品組合的多樣性。

業 務

本集團研發團隊建基台灣。於最後實際可行日期，本集團的研發團隊由合共10名成員組成，全體成員均達大專學歷或以上。本集團的研發團隊由本集團高級管理層團隊成員陳美玲女士領導，彼於1999年6月自台灣台中東海大學取得化學碩士學位，並擁有逾16年半導體行業經驗，曾歷任要職。

本集團的離散式功率半導體使用由本集團內部研發團隊開發的自有專利元件結構及製造方法。截至2015年12月31日止兩個年度以及2016年（直至最後實際可行日期），本集團在三個司法管轄區（即台灣、美國及中國）分別提交10、8及5項離散式半導體／製造方法專利的註冊申請。有關本集團的專利詳情，請參閱本文件附錄四「B.有關本集團業務的進一步資料—2.知識產權」一段。往績記錄期間內，作為生產流程的一部分，應用本集團專利元件結構進行晶圓加工的步驟外包予外聘晶圓加工廠。

本集團研發團隊的主要重心在於開發自主元件結構以及相關製造方法。董事認為，本集團的離散式功率半導體的競爭優勢之一在於其專利元件結構。

本集團的專利元件結構允許更密集封裝（即更高效利用半導體材料），從而在採用某一特定封裝大小下，其離散式半導體相對其他離散式半導體性能較佳。換而言之，據董事告知，本集團的專利元件結構允許較高電流通過離散式半導體的半導體材料，而正向壓降則低於同一大小的表面積，藉此以較低傳熱減低能耗，就某一特定封裝尺寸達至相對其他類似離散式功率半導體而言較佳的性能。另一方面，本集團的專利製造流程允許以較少步驟加工元件結構，藉此節省加工成本。

就封裝而言，據董事告知，倘若本集團有意根據自有專利元件結構擴展其提供的離散式功率半導體至其他封裝類型，包括其他各代的類型，則本集團可向外聘封裝公司外判該等新封裝類型的封裝，或採購所需的設備及機器，以於內部進行該等新封裝類型的封裝。

截至2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月，(i)本集團研發團隊的薪金分別約為367,000美元、418,000美元及147,000美元；及(ii)研發開支分別約為102,000美元、186,000美元及60,000美元。

本集團的研發流程一般涉及元件結構的設計、模擬及測試，包括但不限於通過電腦軟件設計模擬以及通過測試設備測試原型。截至2014年12月31日止年度，已產生的研發

業 務

開支中，約60.3%直接有關蕭基二極管的開發，而約18.8%則直接有關MOSFET的開發，截至2015年12月31日止年度，約56.9%直接有關MOSFET的開發，而約8.1%則直接有關蕭基二極管的開發。截至2016年3月31日止三個月，研發開支中約93.6%直接與開發MOSFET有關，而約6.4%則直接與開發蕭基二極管有關。

產品使用周期

自本集團於2006年成立以來，本集團一直專注於開發及生產以各種封裝術及大小封裝的蕭基二極管為主的離散式功率半導體。

本集團的研發工作透過盡量減低其離散式功率半導體的正向電壓及反向電流，持續改善其產品，以符合最終用家的要求，從而維持本集團蕭基二極管產品競爭力及延長其使用週期。

本集團蕭基二極管2009年起成功開發並投產的同時，通過離散式功率半導體的性能持續改善以及封裝系列擴大，本集團蕭基二極管的產品使用週期至今一直延長。在本集團離散式功率半導體主要封裝類型中，TO-220、TO-247、TO-277及ITO-220封裝類型的銷售相當於本集團截至2015年12月31日止兩個年度收入約88.4%及91.3%，均於2015年錄得出售件數增長。

為擴展其有售產品，本集團亦於2015年完成開發其首個MOSFET產品型號。MOSFET是於多種電子器材的電源供應器中用作整流器中的晶體管。與蕭基二極管相若，本集團將不時改善MOSFET的性能，而由於本集團的MOSFET現正處於建立產品組合階段，而本集團將開發更多不同規格的MOSFET產品型號，藉此擴大MOSFET的產品組合。

客戶

離散式功率半導體銷售

本集團客戶主要為分銷商，彼等繼而轉售本集團的產品予本集團產品的直接用家，即主要為電源供應器製造商，電源供應器將於其後用於多項電子器材。就董事所深知，於電源供應器中內置本集團離散式功率半導體的電子器材，計有流動電話、筆記簿型電腦及LED電視等電子消費品，以至汽車及太陽能板等。

本集團的銷售團隊與本集團的分銷商合作以推廣本集團的產品，包括產品培訓及簡報，並與最終用家合作為本集團產品取得認證及成為最終用家的認可供應商。凡該等所採購零件將於該等最終用家產品最終採用的，作為分銷商的本集團客戶，一般須向本集

業 務

團等名列最終用家認可供應商名單的認可供應商採購元件。除經認可供應商名單機制，董事相信，本集團客戶及本集團產品的直接／最終用家購買本集團旗下品牌的離散式功率半導體的原因，主要在於(i)本集團的離散式功率半導體使用其本身專利元件結構及製造方法，可讓性能更佳；及(ii)本集團產品的質量及可靠性，本集團已就此通過本集團產品若干最終用家(包括品牌消費電子產品知名製造商)進行的質量審核。

原材料貿易

本集團採購EPI作為其主要原材料，該半導體材料為生產加工晶圓的核心原材料。本集團出售其部分EPI予中國晶圓代工廠公司(位於中國深圳的晶圓代工廠，於往績記錄期間內為本集團五大供應商之一)，本集團再向其採購以本集團所售同類EPI生產的加工晶圓。截至2016年3月31日止三個月，中國晶圓代工廠公司亦為本集團五大客戶之一。有別於本集團提供晶圓加工服務的其他分包商，中國晶圓代工廠公司的業務慣例為向其客戶採購EPI並返售加工晶圓，而非僅就晶圓加工流程收取分包費。截至2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月，本集團向中國晶圓代工廠公司分別出售約22,000件、28,000件及10,000件EPI(每件直徑六吋)。

截至2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月，向中國晶圓代工廠公司的EPI銷售分別約為1.1百萬美元、1.4百萬美元及0.5百萬美元，分別相當於本集團收入約6.8%、7.7%及8.9%，同時，向中國晶圓代工廠公司採購加工晶圓分別約達1.8百萬美元、2.5百萬美元及0.8百萬美元，分別相當於本集團銷售成本約15.9%、19.6%及19.7%。

各大客戶

截至及2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月，最大客戶宏標殷達電子有限公司(截至2015年12月31日止兩個年度)及凱恩傑科技股份有限公司(截至2016年3月31日止三個月)貢獻的收入百分比分別約達13.7%、16.4%及20.0%，而五大客戶貢獻的收入百分比合計分別約達57.1%、61.8%及67.2%。

業 務

下文所載為往績記錄期間本集團按收入貢獻劃分的主要客戶收入詳情：

截至2014年12月31日止年度：

排名	客戶	收入 千美元	佔總收入概約 % %
1	宏標殷達電子有限公司	2,230	13.7
2	浩陽半導體股份有限公司	2,201	13.6
3	聯傑科技股份有限公司	1,902	11.7
4	客戶 A	1,486	9.2
5	港晟電子(香港)有限公司	<u>1,451</u>	<u>8.9</u>
	五大客戶合計	9,270	57.1
	所有其他客戶	<u>6,951</u>	<u>42.9</u>
	總收入	<u><u>16,221</u></u>	<u><u>100.0</u></u>

截至2015年12月31日止年度：

排名	客戶	收入 千美元	佔總收入概約 % %
1	宏標殷達電子有限公司	2,975	16.4
2	聯傑科技股份有限公司	2,696	14.9
3	翔億科技股份有限公司	1,965	10.9
4	浩陽半導體股份有限公司	1,943	10.7
5	港晟電子(香港)有限公司	<u>1,609</u>	<u>8.9</u>
	五大客戶合計	11,188	61.8
	所有其他客戶	<u>6,907</u>	<u>38.2</u>
	總收入	<u><u>18,095</u></u>	<u><u>100.0</u></u>

業 務

截至2016年3月31日止三個月：

排名	客戶	收入 千美元	佔收入總額 概約% %
1	凱恩傑科技股份有限公司	1,122	20.0
2	翔億科技股份有限公司	810	14.4
3	聯傑科技股份有限公司	765	13.6
4	浩陽半導體股份有限公司	576	10.3
5	中國晶圓代工廠公司	498	8.9
	五大客戶合計	3,711	67.2
	所有其他客戶	1,840	32.8
	收入總額	5,611	100.0

下表所載為上表所述的本集團各大客戶的背景資料：

客戶	主營業務	所在地	業務關係年期
宏標殷達電子有限公司	分銷電子元件	香港	3年以上
浩陽半導體股份有限公司	分銷電子元件	台灣	6年以上
聯傑科技股份有限公司	分銷電子元件	台灣	6年以上
客戶A	分銷電子元件	台灣	6年以上
港晟電子(香港)有限公司	分銷電子元件	香港	6年以上
翔億科技股份有限公司	分銷電子元件	香港	6年以上
凱恩傑科技股份有限公司	分銷電子元件	台灣	6年以上

2015年12月1日，本集團終止與客戶A的分銷安排。2015年2月，一間美國上市跨國公司訂立確切協議收購客戶A，其已於2015年6月完成。董事確認，終止與客戶A的分銷

業 務

安排的理由為，本公司獲悉由於客戶A的收購事項，客戶A的業務重心將自分銷離散式半導體轉移至分銷其他電子元件及單元。

宏標殷達電子有限公司為一間香港上市公司的附屬公司。浩陽半導體股份有限公司為台灣註冊成立的私營公司。聯傑科技股份有限公司為台灣註冊成立的私營公司。客戶A為一間美國上市公司的台灣附屬公司。港晟電子(香港)有限公司為香港註冊成立的私營公司。翔億科技股份有限公司為香港註冊成立的私營公司。凱恩傑科技股份有限公司為台灣註冊成立的私營公司。

概無董事、彼等之緊密聯繫人或於最後實際可行日期擁有本公司已發行股本5%以上的任何股東於往績記錄期間在本集團任何五大客戶中擁有任何權益。

客戶集中度

截至2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月，本集團五大客戶(作為分銷商)分別佔收入總額約57.1%、61.8%及67.2%，而本集團最大客戶則佔截至2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月本集團收入總額約13.7%、16.4%及20.0%。儘管往績記錄期間上述數字顯示客戶集中，董事認為，本集團並無依賴任何單一客戶，此乃由於：

- (i) 本集團為本集團產品最終用家認可供應商名單上的認可供應商，其質量及可靠性符合相關規定，而本集團分銷商一般須為其客戶向認可供應商採購；及
- (ii) 本集團產品直接用家(即主要為電源供應器製造商)一般為其採購委聘多名分銷商。倘若分銷商不再分銷本集團產品，本集團向個別直接用家的產品分銷可能重新指定予其他分銷商。

與客戶的一般委聘條款

本集團客戶主要為分銷商，彼等繼而向本集團產品的直接用家轉售，即主要為電源供應器製造商，電源供應器將於其後用於多種電子器材。本集團與各分銷商訂立分銷協議以規管本集團產品的分銷安排。

有關本集團與其分銷商訂立的分銷協議的進一步詳情，請參閱本文件「業務—銷售及營銷—銷售及分銷渠道」一節。

業 務

信貸政策

本集團向其客戶提供的信貸期為交付月份後30日至60日不等，即信貸期最高可達60至90日（倘若於月初交付）。因此，本集團允許的信貸期實際上為30日至90日。截至2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月，平均貿易應收款項週轉期分別約為64.8日、70.1日及66.1日。向本集團客戶的付款一般以電匯形式進行。

季節性

董事認為，往績記錄期間，由於下半年的傳統節慶有助電子產品開支增加，本集團產品的需求於下半年高於上半年。

供應商

往績記錄期間，屬本集團業務特有，而為使本集團持續經營業務定期需要的貨品及服務供應商包括：

- (i) 供應半導體物料（即EPI，以供生產加工晶圓）、加工晶圓及導線架及成形壓料等封裝半導體用物料的材料供應商；
- (ii) 本集團聘用以進行若干生產流程的分包商，包括但不限於晶圓加工、封裝及電鍍；及
- (iii) 業務經營所需的其他雜項貨品及服務供應商。

業 務

下表所載為本集團銷售成本詳情：

	截至12月31日止年度				截至3月31日止三個月			
	2014年		2015年		2015年		2016年	
	千美元	佔成本 總額%	千美元	佔成本 總額%	千美元 (未經審核)	佔成本 總額%	千美元	佔成本 總額%
材料成本								
— EPI	2,571	22.1%	2,280	17.6%	548	21.6%	696	17.7%
— 晶圓	1,635	14.1%	2,538	19.6%	426	16.8%	772	19.7%
— 導線架	1,417	12.2%	1,446	11.2%	321	12.6%	458	11.7%
— 成型壓料	289	2.5%	348	2.7%	66	2.6%	89	2.3%
— 其他材料成本	660	5.7%	952	7.4%	192	7.5%	295	7.5%
小計	6,572	56.6%	7,564	58.5%	1,553	61.1%	2,310	58.9%
分包成本								
— 晶圓加工	2,788	24.0%	2,943	22.8%	532	20.9%	846	21.5%
— 組裝封裝	668	5.8%	327	2.5%	42	1.7%	124	3.2%
— 電鍍	257	2.2%	309	2.4%	61	2.4%	102	2.6%
小計	3,713	32.0%	3,579	27.7%	635	25.0%	1,072	27.3%
其他直接成本	1,326	11.4%	1,788	13.8%	353	13.9%	543	13.8%
	11,611	100.0%	12,931	100.0%	2,541	100.0	3,925	100.0

往績記錄期間，本集團毛利率分別穩定維持於約28.4%、28.5%及30.0%。有關材料成本及分包成本的假設波動對往績記錄期間內各期間的毛利及純利影響的敏感度分析，請參閱本文件「財務資料—經營業績主要組成部分—銷售成本—敏感度分析」一節。

各大供應商

截至2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月，源自本集團最大供應商的本集團採購總額百分比分別約達向供應商採購總額的27.7%、24.0%及31.6%，而本集團向本集團五大供應商的採購總額百分比合計分別約達向供應商採購總額的78.4%、78.5%及82.8%。

業 務

下文所載為往績記錄期間內本集團按各大供應商劃分的向外部供應商採購總額詳情，包括材料成本及分包成本：

截至2014年12月31日止年度：

排名	供應商	本年度 採購額 千美元	佔採購總額 概約% %
1	供應商A	3,021	27.7
2	供應商B	2,571	23.6
3	中國晶圓代工廠公司	1,850	17.0
4	寧波華龍電子股份有限公司(「寧波華龍」)	807	7.4
5	供應商D	289	2.7
	五大供應商合計	8,538	78.4
	所有其他供應商	2,357	21.6
	本年度採購總額	<u>10,895</u>	<u>100.0</u>

截至2015年12月31日止年度：

排名	供應商	本年度 採購額 千美元	佔採購總額 概約% %
1	供應商A	2,644	24.0
2	中國晶圓代工廠公司	2,539	23.1
3	供應商B	2,280	20.7
4	寧波華龍	776	7.1
5	供應商E	401	3.6
	五大供應商合計	8,640	78.5
	所有其他供應商	2,364	21.5
	本年度採購總額	<u>11,004</u>	<u>100.0</u>

業 務

截至2016年3月31日止三個月：

排名	供應商	本期間 採購額 千美元	佔採購總額 概約 % %
1	供應商B	1,178	31.6
2	供應商A	783	21.0
3	中國晶圓代工廠公司	773	20.7
4	寧波華龍	178	4.8
5	展華電子材料(常熟)有限公司 (「展華電子」)	174	4.7
	五大供應商合計	3,086	82.8
	所有其他供應商	644	17.2
	期內採購總額	3,730	100.0

下表所載為上表所述本集團各大供應商的背景資料：

供應商	主營業務	所在地	業務關係年期
供應商A	晶圓代工	台灣	4年以上
供應商B	EPI製造	美國	4年以上
中國晶圓代工廠公司	晶圓代工	中國	4年以上
寧波華龍	導線架代工	中國	4年以上
供應商D	化工材料製造	中國	4年以上
供應商E	晶圓代工	台灣	3年以上
展華電子	導線架代工	中國	2年以上

供應商A為一間台灣上市公司。供應商B為一間台灣上市公司的美國附屬公司。中國晶圓代工廠公司為一間在中國註冊成立的中外合資企業。寧波華龍為一間在中國註冊成立的中外合資企業。供應商D為台灣上市公司的中國附屬公司。供應商E為一間在台灣註冊成立的私營公司。展華電子為一間在中國註冊成立的私營公司。

業 務

概無董事、彼等之緊密聯繫人或於最後實際可行日期擁有本公司股本5%以上的任何股東於往績記錄期間內在本集團任何五大供應商中擁有任何權益。

本集團存置認可供應商及分包商名單，此乃參照(其中包括)材料／服務質量、可靠性及價格選用。本集團挑選供應商及分包商時，對將供應的原／加工材料進行測試。本集團亦就原材料／服務質量、可靠性和及時交付對供應商及分包商進行每月評核。往績記錄期間內，本集團自其供應商採購材料／服務時並無出現任何困難，以致對本集團業務經營造成重大不利影響。往績記錄期間，本集團並無出現任何原材料及服務供應商短缺。

供應商集中度

截至2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月，本集團五大供應商分別約佔其年內向供應商採購總額78.4%、78.5%及82.8%，而截至2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月，本集團年內向供應商採購總額中源自其最大供應商的分別約為27.7%、24.0%及31.6%。儘管上述往績記錄期間數字顯示供應商集中，董事認為本集團並非依賴任何單一供應商，此乃由於：

- (i) 本集團存置一份認可供應商及分包商名單，包括活躍及後備供應商，彼等已通過對所供應原材料、元件及服務的測試。本集團主要供應商變動通過產品／流程修訂通知告知本集團客戶及產品最終用家。本集團向若干材料／服務的供應商／分包商採購，例如作為本集團主要生產流程之一的晶圓加工。倘若一名供應商不再向本集團供貨，本集團可自名單選用認可供應商作為替補，以避免供應商中斷，並確保其質量；及
- (ii) 董事認為，市場上有大量本集團生產所使用的原材料、部件及服務供應，供應商數目眾多，而本集團可於恰當的情況及時間在市場上尋求替補供應商而無重大限制。

供應協議

就採購原／加工材料及服務而言，本集團一般與其供應商及分包商訂立框架供應協議，規管將就採購發出的採購訂單的一般條款。各採購訂單經參考各框架協議後載列各

業 務

宗交易的所有條款及條件。下文所載為框架供應協議的主要條款：

協議條款

框架供應協議一般合同年期最高為五年，可自動或經互相同意後重續，而若干框架供應協議並無固定年期，直至訂約方經磋商另行終止為止。

下達訂單及付運

本集團將下達採購訂單以進行每宗採購，各採購訂單載列（視乎情況而定）所須產品、設計及規格。若干框架供應協議要求本集團向供應商／分包商提供一般為期三個月至六個月的滾動採購預測。每宗採購訂單的付運安排參考框架協議的條款釐定，一般參考國際認可的貿易商業條款釐定。

定價及付款條款

材料／服務的定價以及付款條款將就每宗交易磋商，並將載列於採購訂單。往績記錄期間，本集團的銷售成本主要以美元計值，其分別佔本集團截至2015年12月31日止兩個年度的銷售成本約67.7%及61.3%。本集團一般以電匯方式結算採購付款。本集團供應商授出的信貸期介乎交付月份後30日至60日不等。就截至2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月，平均貿易應付款項週轉期分別約為25.8日、22.3日及25.7日。

質量保證及保修

本集團有權就設計及所要求規格，以及電性等其他具體特質檢驗／測試所購原／加工材料。一般而言，本集團有權在規定時限內向供應商／分包商知會所發現的任何欠妥之處／不符規格之處，以要求退貨或替換。根據若干框架供應協議，本集團亦有權要求自供應商／分包商取得有關欠妥之處／不符規格之處分析的書面報告。

保密及知識產權

框架供應協議訂約方承諾不披露及不使用有關交易的所有機密資料，惟獲豁免者除外，以及不侵犯任何人士的知識產權或任何合法權利。

業 務

終止

一般而言，對框架供應協議任何條款有任何違責而不改正／補救者，非違責方可終止框架供應協議。因無力償債、有關框架供應協議任何一方無力償債／破產的任何重組、重新調整等安排、委任接管人或為債權人利益而作出任何指讓的，框架供應協議亦可予終止。

存貨管理

本集團一般主要按其生產所需維持原材料及成品存貨水平，其繼而參考其客戶（即分銷商）提供的滾動採購預測作出估計。有關本集團與其分銷商之間的安排的進一步詳情，請參考上文「業務—銷售及營銷—銷售及分銷渠道—分銷協議」一節。本集團進行定期存貨盤點以作存貨管理，確保進貨出貨記錄準確完整。存貨經計及貨齡後，被視為陳舊的將計提撥備。釐定存貨備抵時，本公司管理層將於報告期末審閱存貨賬齡分析，並識別不再適合使用及不可出售的滯銷存貨。

職業健康及安全

本集團須遵守中國的地方法律、國家準則及行業準則的規定以維持安全生產環境，並保障僱員的職業健康。有關該等法律法規的進一步資料，請參閱本文件「監管概覽」一節。根據該等規定，未能維持足夠設施或設備以確保安全生產的任何單位，不得從事生產經營活動。在中國經營的單位應當對從業人員進行安全生產教育和培訓，並為其僱員提供安全生產的環境。生產設施及設備的設計、製造、安裝、使用、檢查及維護須符合中國適用國家或行業標準。

本集團已於本集團的生產設施執行安全措施，並制訂安全生產及職業健康安全指引及緊急應變安全手冊，盡量減低僱員的受傷風險。本集團亦於本集團的生產設施就意外預防及管理為僱員進行定期培訓課程。

董事確認，往績記錄期間，本集團已在所有重大方面遵守相關中國健康和工作場所安全監管規定，且並無出現任何事故或投訴，以致對本集團的財務狀況或業務經營造成重大不利影響。據本集團中國法律顧問告知，並經地方政府機關確認及於順德區安全生產監督管理局網站所顯示，往績記錄期間，本集團概無因對中國任何健康及安全法律法規的違規事故而被實施任何行政制裁或處分，以致對本集團財務狀況或業務經營造成重大不利影響。

業 務

環保合規

本集團業務須遵守相關中國國家及地方環保法律法規，例如《中華人民共和國環境保護法》。該等法律法規監管廣泛環保事宜，例如大氣污染、噪聲排放、廢水及廢料排放。本文件「監管概覽—中國法律—有關環保的法律法規」一節載有本集團適用的環保法律法規概要。

董事相信，本集團的生產流程並無產生環境危害物，且不會以其他方式對環境造成重大不利影響，而本集團的環保措施充分，足以符合所有適用的中國現行地方及國家法規。

2016年2月23日，本集團取得中國相關環境機關的環境影響評價批准。2016年4月5日，本集團取得中國相關環境機關的竣工環境保護驗收，並取得正式生產批准。2016年4月20日，本集團取得中國相關環境機關的排放許可證。

節能元件(廣東)於取得環境影響評價前開始試產。

根據《國務院關於第一批取消62項中央指定地方實施行政審批事項的決定》試生產現已不再需要環境機關批准。

根據廣東省人大常委會頒佈的《廣東省環境保護條例》，建設項目未提交環境影響評價報告，或該等報告未經批准，擅自開工建設的，由負有環境保護監督管理職責的主管環保部門責令停止建設，處人民幣100,000元以上人民幣200,000元以下罰款，並可以責令恢復地盤原狀。節能元件(廣東)自2016年1月1日起未有取得環境影響評價而開始試生產。

經諮詢順德區環保局(即有關環保的主管機關)，本集團的中國法律顧問告知：

- (1) 根據《建設項目環境保護設施竣工驗收管理規定》以及當局的當地慣例，一間公司須於試生產階段開始後三個月內正式完成竣工環境保護驗收，並須於完成竣工環境保護驗收後15日內取得排污許可證；

業 務

- (2) 由於節能元件(廣東)已取得環境影響評價而並無造成任何重大環境污染事故，環保主管機關一般不會對取得環境影響評價前進行試生產施加任何行政處分；
- (3) 在試生產期間內，除非發生嚴重環境污染事故，否則一般將不會實施行政處分；及
- (4) 節能元件(廣東)應可於取得環境影響評價批准後三個月內取得竣工環境保護驗收。

如中國順德區環保局網站所示，直至最後實際可行日期，概無因對任何中國環保法律或法規的不合規而對節能元件(廣東)實施行政處分。

據向主管環保機關作出的諮詢，本集團中國法律顧問確認：

- (1) 節能元件(廣東)已取得相關環境機關環境影響評價、竣工環境保護驗收及排放許可證，並正式投產；
- (2) 中國法律顧問已向主管環保機關查詢，並獲悉節能元件(廣東)現已正式辦妥環保手續，且並無發生嚴重環境污染事故，因此，概將不會向節能元件(廣東)施加行政處分；
- (3) 倘若節能元件(廣東)在試生產期間遵守相關法律法規，如並無發生重大環保事故，主管環保機關一般將不會實施行政處分；及
- (4) 直至最後實際可行日期，概無因發現對環保法律不合規而對節能元件(廣東)已經實施／將會實施行政處分。

鑒於前述各項，中國法律顧問認為，節能元件(廣東)於取得環境影響評價前作試運行此一事實，並不構成重大不合規。

往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本集團並無就本集團的生產接獲有關污染的任何通知或警告，本集團亦無因不遵守中國任何環保法律以致面臨中國政府機關的任何罰款、處分或其他法律訴訟，而據董事經作出一切合理查詢後所悉，本公司並無面臨或待決的任何中國環境政府機關就此提起的任何訴訟。

保險

本集團已投購以下各段所載的保單。

業 務

僱員賠償保險

本集團已遵照中國、香港及台灣的法律法規為本集團僱員向養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險及生育保險以及社會保險供款。

機器保險

就順德生產廠房而言，本集團已針對火災、偷竊導致的虧損或損害等投購承保生產設備及若干存貨的保險。

晶圓及半成品運輸保險

本集團亦就運輸及倉儲過程中因意外產生的任何潛在損失對在台灣境內運輸晶圓及半成品投購陸上運輸保險。

往績記錄期間及直至最後實際可行日期，據董事確認，本集團並無就其保單提出任何重大申索。董事認為，就本集團現有業務經營及通行行業常規而言，現有承保範圍充分且符合行業慣例。本集團將就本集團的承保範圍繼續檢討及評估本集團的風險概況，並按本集團在中國、香港、台灣及其他相關司法管轄區的業務需要及行業常規，對保險常規作出必須及恰當調整。

對沖

本集團面對外幣風險。截至2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月，以本集團的申報貨幣(即美元)以外貨幣結算的本集團銷售分別約達18.1%、19.7%及25.2%，而並非以本集團的申報貨幣結算的銷售成本則分別約32.3%、38.7%及39.3%。

於最後實際可行日期，本集團並無針對貨幣風險或利率風險訂立任何對沖交易。儘管本集團日後可尋求訂立對沖交易，惟貨幣或利率對沖交易的可得性及成效可能有限，而本集團或未能成功或完全不能成功對沖所面對的貨幣風險或利率風險。

業 務

僱員

員工數目及按職能劃分僱員

2014年12月31日、2015年12月31日及2016年3月31日以及最後實際可行日期，本集團分別有合共137名、149名、135名及147名僱員（包括SDMM節能元件分部員工）。本集團僱員駐於中國、香港及台灣。

下文載列於最後實際可行日期按職能劃分的本集團僱員數目：

	香港	台灣	中國	總計	佔總額%
生產線工人	—	—	68	68	46
工程師	—	2	6	8	5
銷售及營銷	1	10	8	19	13
採購	—	3	2	5	3
質量管理	—	6	5	11	8
存貨管理及物流	1	2	6	9	6
研發	—	10	—	10	7
管理	1	3	2	6	4
財務及會計	1	3	3	7	5
總務及其他	—	—	4	4	3
總計	4	39	104	147	100

與員工的關係

董事認為，本集團一直與其僱員維持良好關係。董事確認，本集團已遵守中國、香港及台灣所有適用勞工法律法規。

董事確認，往績記錄期間內，本集團並無與其僱員出現任何重大問題，或因勞資糾紛而導致其營運受干擾，或本集團於挽留資深員工或熟練人手方面有任何困難。節能元件（廣東）的工會於2016年7月成立。

培訓及招聘政策

董事相信，員工質素對維持本集團經營及生產效率以及本集團產品質量的一致性功不可沒。本集團擬盡最大努力延攬及挽留恰當及適合人員服務本集團。本集團按持續基

業 務

準評估可用人力資源，並將決定是否須順應本集團業務發展增聘人手。本集團向其僱員提供內部指引、質控手冊及緊急應變安全手冊，說明本集團的內部規則。本集團就技術訣竅、安全教育及工作實用技巧等範疇每月向本集團員工提供定期培訓。

薪酬政策

本集團根據中國、香港及台灣適用就業法律與每名本集團僱員訂立個別僱傭合約。

香港

在香港，本集團已參與香港法例第485章《強制性公積金計劃條例》所訂明的強制性公積金。最後實際可行日期，本集團已根據上述法例繳納所有必要供款。

中國

在中國，本集團已參與於2010年10月28日頒佈並於2011年7月1日施行的《中華人民共和國社會保險法》所訂明的基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險以及生育保險，以及於1999年4月3日頒佈及施行，並於2002年3月24日修訂的《住房公積金管理條例》所訂明的住房公積金。於最後實際可行日期，本集團已根據前述法律法規繳納所有必要供款。

台灣

在台灣，本集團已參與1958年7月21日頒佈、1960年2月24日實施，並於2015年7月1日進一步修訂的《勞工保險條例》，2004年6月30日頒佈、2005年7月1日實施，並於2015年7月1日進一步修訂的《勞工退休金條例》以及1994年8月9日頒佈、1995年3月1日實施以及於2011年6月29日進一步修訂的《全民健康保險法》訂明的基本年金制度、基本醫療保險及工傷保險。於最後實際可行日期，本集團已根據前述法律法規繳納所有必要供款。

物業

租賃物業

下文所載為本集團在中國、台灣及香港的物業權益概要。董事確認，於最後實際可行日期，本集團並無在中國、台灣及香港自置任何物業。

業 務

編號	地點	建築面積 (概約)	年期	業主	租約主要條款	用途
中國						
1.	中國 廣東 佛山順德北滘 三樂東路18號 B幢1樓至4樓	4,160平方米	2015年10月1日 至2017年 9月30日	順德多媒體	每月租金 人民幣50,000元	封裝設施
2.	中國 廣東 佛山順德北滘 三樂東路18號 A幢4樓	1,000平方米	2015年10月1日 至2017年 9月30日	順德多媒體	每月租金 人民幣15,000元	辦公室
3.	中國 深圳福田區 石廈北二街 新世紀商務中 心 A棟612室	143.3平方米	2016年8月17日 至2018年 4月30日	(i) 業盈置業 (就2015年 5月1日至2016 年8月16日期 間) (ii) 迅速資產管 理(自2016年 8月17日後)	每月租金 人民幣17,200元	辦公室
4.	中國 深圳福田區 石廈北二街 新世紀商務中 心 A棟613室	135.7平方米	2016年8月17日 至2018年 4月30日	(i) 業盈置業 (就2015年 5月1日至2016 年8月16日期 間) (ii) 迅速資產管 理(自2016年 8月17日後)	每月租金 人民幣16,300元	辦公室
5.	中國 深圳福田區 漁農村 景源華庭 A座1003室	92.9平方米	2015年1月23日 至2017年 1月22日	獨立第三方	每月租金 人民幣7,280元	員工宿舍
台灣						
1.	台灣 新北市 新店區 民權路86號 3樓A室	142.4平方米	2016年1月1日 至2017年 12月31日	獨立第三方	每月租金 新台幣54,280元	辦公室
2.	台灣 新北市 新店區 民權路82號 3樓D室	409.9平方米	2016年3月1日 至2017年 12月31日	獨立第三方	每月租金 新台幣156,240元	辦公室
3.	台灣 新北市 新店區 中正路501號 19樓4F室 郵遞區號：231	277.9平方米	2015年2月15日 至2017年 2月14日	獨立第三方	每月租金 新台幣45,000元	倉庫
4.	台灣 新北市 新店區 民權路82號 停車場車位 B1-129、B3- 004、B3-006、 B3-007、B3-002 號	不適用	2016年3月1日 至2017年 12月31日	獨立第三方	每月租金 新台幣20,000元	車位

業 務

編號	地點	建築面積	年期	業主	租約主要條款	用途
		(概約)				
5.	台灣 新北市 新店區 民權路86號 停車場車位 B1-109、B1-111、B3-011號	不適用	2016年1月1日 至2017年 12月31日	獨立第三方	每月租金 新台幣12,000元	車位
	香港					
1.	香港 柴灣 利眾街12號 蜆壳工業大廈 1樓及4樓	46.5平方米及 92.9平方米	2016年1月1日 至2017年 12月31日	蜆壳電器	每月租金17,550港元 (包括管理費)	廠房及 辦公室

往績記錄期間，本集團於重續租賃時並無出現任何困難。本集團租賃的若干物業來自本公司關連人士，當中包括順德多媒體、業盈置業以及蜆壳電器。有關租賃詳情，請參閱本文件「獲豁免持續關連交易」一節。

知識產權

本集團設計及開發元件結構及製造方法，以供其離散式功率半導體使用。本集團應用專利及商標等各項技術相關知識產權以保障其商業資產及競爭力。

有關本集團知識產權相關的資料，請參閱本文件附錄四「知識產權」一段。

轉移訂價安排

截至2015年12月31日止兩個年度，本集團產品的生產大部分由順德多媒體的SDMM節能元件分部進行。資產重組完成後，本集團的產品生產由節能元件(廣東)承接。

節能元件(台灣)承攬向第三方供應商採購EPI及加工晶圓工作。截至2015年12月31日止兩個年度，所採購EPI及加工晶圓已售予SDMM節能元件分部。資產重組完成後，所採購EPI及加工晶圓直接向節能元件(廣東)出售。截至2015年12月31日止兩個年度，普福斯深圳向節能元件(香港)提供的設計服務於2015年8月終止。

截至2015年12月31日止兩個年度，SDMM節能元件分部向蜆壳多媒體集團出售成品，其繼而向節能元件(台灣)及節能元件(香港)出售，以供向第三方客戶銷售。資產重組完成後，節能元件(廣東)直接向節能元件(台灣)及節能元件(香港)出售成品，以供向第三方客戶銷售。

業 務

截至2015年12月31日止兩個年度及資產重組後，節能元件(香港)亦向蜆壳多媒體集團出售若干成品(即離散式功率半導體)，用作彼等生產電器的原材料，截至2015年12月31日止年度，少量由節能元件(台灣)向蜆壳多媒體集團出售。

有關本集團業務流的進一步詳情，請參閱本文件「業務—業務模式—資產重組前後本集團業務流的說明」一節。

本集團已委聘立信稅務檢討本集團的轉移訂價安排，以評核截至2015年12月31日止兩個年度以及資產重組完成後截至2016年3月31日止三個月(「檢討期間」)本集團對適用轉移訂價指引的合規情況以及對本集團的潛在稅務涵義。立信稅務為英國擔保有限公司BDO國際的成員公司立信會計師事務所(特殊普通合伙)的一部分，並構成BDO國際獨立成員商號網絡的一部分。立信稅務為提供(其中包括)稅務相關顧問服務的公司，過往曾從事在聯交所上市以及準備在香港上市的若干公司的項目。立信稅務工作小組包括中國註冊稅務師協會以及國稅局稅務司的會員。

節能元件(廣東)於2016年1月至3月期間的淨成本加成率(「淨成本加成率」)(附註)為2.03%。立信稅務認為，從事晶圓封裝業務的製造承包商的淨成本加成率四分位距一般介乎1%至7%之間。因此，自中國轉移定價角度而言，立信稅務並無發現節能元件(廣東)於2016年1月至3月期間進行的關聯方交易有違公平原則的證據。

立信稅務選用交易淨利潤法(「交易淨利潤法」)對節能元件(台灣)及節能元件(香港)的關聯方分銷業務進行公平性質測試。在交易淨利潤法分析中，營業利潤率(「營業利潤率」)選用為恰當利潤水平指標。

就節能元件(台灣)而言，根據基準結果，節能元件(台灣)的營業利潤率高於從事分銷業務的可資比較公司所得出的營業利潤率四分位距。因此，自台灣轉移定價角度而言，立信稅務並無發現任何證據，足以顯示節能元件(台灣)於截至2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月進行的關聯方交易有違公平原則。

節能元件(香港)於截至2015年12月31日止兩個年度產生低於其可資比較公司所得出的營業利潤率四分位距的經營虧損。然而，節能元件(香港)於2016年1月至3月期間的營業利潤率為10.10%，高於其可資比較公司所得出的營業利潤率四分位距。然而，由於節能元件(香港)於往績記錄期間錄得虧損，以致低於立信稅務分析的基準結果，香港稅務當局保留權利，就評稅目的調整節能元件(香港)的利潤水平。然而，立信稅務

附註：淨成本加成率為一種成本回報計量，其按年度經營利潤除以經營成本計算。

業 務

認為，由於該等虧損由節能元件(香港)僅於2015年開始向外部客戶進行銷售以致銷售活動量低此一事實導致，香港稅務當局就評稅目的調整利潤水平的機會甚低。於2015年向外部客戶進行銷售前，節能元件(香港)於2013年開始向蜆壳多媒體集團出售離散式功率半導體，截至2015年12月31日止兩個年度的金額僅分別約達13,000美元及16,000美元。據立信稅務告知，就課稅目的而言，節能元件(香港)自調整節能元件(香港)利潤水平而產生的潛在稅務責任上限將約為25,000美元。考慮到節能元件(香港)於截至2015年12月31日止兩個年度產生虧損，而節能元件(香港)於截至2016年1月至3月期間的利潤水平高於其可資比較分銷商所得出的營業利潤率四分位距的前述因素，自香港轉移定價角度而言，立信稅務並無發現任何證據，足以顯示節能元件(香港)於截至2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月進行的關聯方交易有違公平原則。

就普福斯深圳而言，立信稅務認為，由於普福斯深圳於往績記錄期間錄得虧損，其低於立信稅務分析的基準結果，中國地方稅務當局保留權利，就評稅目的調整普福斯深圳的利潤水平。儘管如此，立信稅務認為，由於普福斯深圳的交易金額甚低，中國稅務當局就評稅目的調整利潤水平的機會甚低。此外，普福斯深圳於2016年6月22日取消註冊。據立信稅務告知，由於普福斯深圳已經取消註冊，相關稅務機關不得針對普福斯深圳採取任何進一步行動，普福斯深圳概無任何未繳稅務負債。

據董事確認，截至最後實際可行日期，相關稅務機關，即(i)就節能元件(台灣)而言為台灣財政部北區國稅局；(ii)就節能元件(廣東)而言為廣東省佛山市國家稅務局及佛山市順德區地方稅務局北滘稅務分局；及(iii)就節能元件(香港)而言為香港稅務局，並無就本集團對適用轉移訂價指引的合規進行任何查詢或調查。控股股東根據彌償保證契據以本公司為受益人的彌償保證將涵蓋自本集團於[編纂]成為無條件日期或之前的轉移訂價安排而產生的任何潛在稅務負債以及處分。

資產重組完成後，節能元件(台灣)、節能元件(廣東)及節能元件(香港)繼續奉行現有關連交易定價政策，立信稅務認為，根據相關轉移訂價指引，此舉符合公平原則。日後，假設本集團奉行現有關連交易定價政策，並對利潤水平進行定期檢討，確保節能元件(台灣)、節能元件(廣東)及節能元件(香港)於各財政年度各自維持一定水平的利潤率，則本集團應毋須承擔轉移訂價安排產生的任何潛在額外稅項負債。

業 務

本集團已採納以下措施，確保持續遵守台灣、中國及香港的相關轉移訂價法律法規：

- 本集團應用及監察轉移訂價安排，以確保本集團的關連交易乃根據適用轉移訂價指引遵照公平原則進行；
- 監察各附屬公司利潤水平，以確保不時的轉移訂價安排有效；
- 關連交易正式記錄、備案及存置，以備本集團財務及會計團隊查閱，避免向中國稅務機關提交任何備案前有任何差異；及
- 本集團財務及會計團隊將監察關連交易的金額，以釐定是否需要編製有關轉移訂價的同步文件記錄報告，並向相關稅務機關提交備案。

於最後實際可行日期，董事並無獲悉台灣、中國或香港的任何稅務機關就本集團的關聯交易有任何查詢、審核或調查。本公司已採納有關持續遵守台灣、中國及香港的相關轉移訂價法律法規的持續合規的所有建議措施。

經考慮上文所述，董事認為，而保薦人同意，該等措施實屬足夠有效。有關本集團的轉移訂價相關風險詳情，請參閱本文件「風險因素—本集團的營運可能須作轉移訂價調整」一節。

不合規

董事確認，往績記錄期間內及直至最後實際可行日期，本集團已在各重大方面遵守所有適用法律、規則及法規。

控股股東作出的彌償保證

控股股東已訂立彌償契據，據此，控股股東已同意在彌償契據的條款及條件規限下，就本集團不遵守適用法律、規則或法規（包括該等有關本集團業務經營的註冊及特許批給規定者）而於[編纂]成為無條件當日或之前可能產生的任何責任及損失向本集團作出彌償。有關彌償契據的進一步詳情，載於本文件附錄四「E. 其他資料」一段。

訴訟及申索

往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本集團概無涉及針對本集團提起的任何訴訟及／或申索。

業 務

執照及證書

下文所載為最後實際可行日期本集團於中國及台灣的業務所須之執照及證書：

執照／證書類型	授出日期	執照／證書屆滿日期
中國		
1. 營業執照	2015年3月9日	2045年3月9日
2. 中國的台港澳僑投資企業批准證書	2015年2月17日	2045年2月16日
3. 組織機構代碼證	2015年3月23日	2019年2月16日
4. 稅務登記證	2015年7月7日	不適用
5. 中國海關報關企業報關注冊登記證書	2015年5月14日	不適用(須年檢)
6. 出入境檢驗檢疫報檢企業備案表	2015年5月6日	不適用
7. 環境影響評價批准(附註)	2016年2月23日	不適用
台灣		
1. 外國公司認許表	2007年10月11日	不適用
2. 外國公司分公司設立登記表	2007年10月11日	不適用

附註：有關本集團遵照中國適用環保法律法規取得所需批准進一步詳情，請參閱本文件「業務—環保合規」一節。

本集團已取得中國相關環境機關環境影響評價、竣工環境保護驗收及排放許可證，並正式投產。有關本集團遵守中國相關環保法律法規的進一步詳情，請參閱本文件「業務—環保合規」一節。

董事確認，本集團已就其於往績記錄期間及直至最後實際可行日期在香港的現有業務經營取得所有相關許可／登記。

據中國法律顧問及台灣法律顧問告知，往績記錄期間內及直至最後實際可行日期，除「業務—環保合規」一節所披露者外，本集團就經營其於中國及台灣的業務，已取得所有相關重要必要執照、許可及批准。

業 務

為確保本集團相關成員公司持續遵守適用規定、法例及法規，本集團行政部應負責以下各項：

- (i) 識別及審閱本集團經營所需的任何批准、許可、執照及證書，並確保遵守相關法例法規；
- (ii) 識別應提供以作申請／提交的任何資料，例如公司概況、工作經驗、資源、財務資料、管理體系及認證、技術建議、進度表、客戶滿意度等；
- (iii) 指定合適人士／部門以根據通行法例及法規跟進在所訂明的時限內向相關機關提交本集團資料；
- (iv) 倘若及在必要之時向本集團客戶提供上文(ii)所述最新資料；
- (v) 根據法定規定及其他相關法規識別新規定、營運及控制程序；及
- (vi) 就適用規定、法律及法規的所有變動向高級管理層團隊成員提供最新資料。

此外，執行董事及合規主任周先生連同執行董事洪先生及非執行董事及高級管理層團隊負責監督本集團適用規定、法律及法規的持續合規，而本集團亦可能於需要的情況下及需要之時諮詢法律顧問。

內控

本集團已委聘獨立內控顧問以對本集團的內控制度(包括財務、營運、合規及風險管理)進行詳細評估，以改善本集團的企業管治等事宜。

獨立內控顧問提供內控檢討服務，過往曾為若干聯交所上市公司及籌備在香港上市的公司開展內控檢討項目。獨立內控顧問工作小組包括香港會計師公會、特許公認會計師公會、英國特許管理會計師公會及國際內部審計師協會會員。

獨立內控顧問於2015年12月開始審閱本集團內控制度的制訂設計及營運成效。

業 務

董事與保薦人意見

根據獨立內控顧問進行的跟進檢討，董事確認並獲保薦人認同，本集團的內控設計並無重大不足之處。